

# 无锡汉咏微电子股份有限公司

Wuxi Herochip Microelectronics Co., Ltd.

## 公开转让说明书

推荐主办券商



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO.,LTD.

二〇一四年七月

## 声 明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项及风险提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点等原因，需要提请投资者应对公司以下重大事项予以充分关注，并应认真考虑相关风险因素。

### 一、公司治理风险

股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行尚需检验，公司治理和内部控制制度仍需逐步完善。随着公司的较快发展，经营规模和业务范围不断扩大，人员不断增多，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

### 二、技术人才短缺风险

公司作为集成电路设计企业，核心竞争力在于自主研发能力和稳定的研发团队。公司的发展很大程度上取决于产品的研发速度，因此公司对高端技术人才有较大需求。国内集成电路企业对于高端集成电路设计人才的争夺日趋激烈，公司能否保留并吸引更多人才，对于公司未来的发展至关重要，所以公司面临技术人员短缺的风险。

### 三、营业区域集中的风险

报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，主营业务收入中来自于华南和华东地区的营业收入合计占主营业务收入总额的比例在2012年度和2013年度分别为92.32%和94.31%，营业区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。因此公司仍存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。

### 四、委托加工风险

公司作为集成电路设计企业，采取“自主研发+委外加工”的经营模式。公

司仅从事集成电路芯片的设计、销售业务，芯片制造、封装、测试等环节需要依赖外部的供应商完成。2012年度公司对前五大供应商合计采购金额为9,001,438.59元，占当年采购总额的90.08%；2013年度公司对前五大供应商合计采购金额为9,757,154.45元，占当年采购总额的91.31%。2012年与2013年主要供应商采购比例均较大，存在一定程度的委外加工风险。

## 五、对非经常性损益依赖风险

公司2012年度、2013年度公司非经常性损益分别为57,618.75元、807,407.91元，主要是2012年度及2013年度获得无锡市人民政府新区管理委员会政府补贴65,850.00元、807,875.00元，政府补贴构成主要为房租补贴、科技企业补贴，2012及2013年度非经常性损益占净利润比例分别为51.24%、261.66%。如果公司业务不能实现更快的增长，在公司无法持续获得政府补贴时，将会对公司今后盈利水平的快速提升产生不利影响。

## 目 录

声 明.....	2
重大事项及风险提示 .....	3
目录.....	5
释义.....	7
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>11</b>
一、公司基本情况.....	11
二、股票挂牌情况.....	11
三、公司股权结构及股东情况.....	13
四、公司股本演变情况.....	15
五、公司设立以来重大资产重组情况.....	20
六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况.....	20
七、最近两年主要财务数据及财务指标.....	23
八、本次挂牌相关的机构.....	24
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>26</b>
一、公司业务情况.....	26
二、公司生产或服务的主要流程及方式.....	31
三、与公司业务相关的主要资源要素.....	35
四、公司主要产品的产能及销售情况.....	42
五、公司商业模式.....	47
六、行业基本情况及公司的竞争地位.....	47
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>54</b>
一、最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况 .....	57
二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估.....	58
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况 .....	59
四、公司独立经营情况.....	59
五、同业竞争情况.....	62
六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况 .....	62
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明.....	63
八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况.....	64

<b>第四节 公司财务</b> .....	65
一、公司报告期的审计意见及主要财务报表.....	65
二、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	73
三、公司报告期主要会计数据和财务指标.....	79
四、报告期利润形成的有关情况.....	81
五、公司报告期主要资产情况.....	88
六、公司报告期内重大债务情况.....	99
七、公司报告期股东权益情况.....	104
八、关联方及关联方交易.....	105
九、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项 .....	107
十、公司报告期内资产评估情况.....	107
十一、股利分配政策和报告期内的分配情况.....	108
十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估	109
<b>第五节 有关声明</b> .....	111
一、公司声明.....	111
二、主办券商声明.....	112
三、律师声明.....	113
四、会计师事务所声明.....	114
五、资产评估机构声明.....	115
<b>第六节 附件</b> .....	116
一、主办券商推荐报告.....	116
二、财务报表及审计报告.....	116
三、法律意见书.....	116
四、公司章程.....	116
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见.....	116

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列词语具有以下含义：

公司、无锡汉咏或股份公 司	指	无锡汉咏微电子股份有限公司
有限公司	指	无锡汉咏微电子有限公司
股东会	指	无锡汉咏微电子有限公司股东会
股东大会	指	无锡汉咏微电子股份有限公司股东大会
董事会	指	无锡汉咏微电子股份有限公司董事会
监事会	指	无锡汉咏微电子股份有限公司监事会
主办券商、国联证券	指	国联证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股份在全国股份转让系统公司进行公开转 让的行为
公司高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司管理层	指	对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员， 包括董事、监事和高级管理人员等
公司章程	指	最近一次由股东大会会议通过的《无锡汉咏微电 子股份有限公司章程》
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监 事会议事规则》
公开转让说明书、本说明 书	指	无锡汉咏微电子股份有限公司公开转让说明书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》（2005年修订）
最近两年、报告期	指	2012年度、2013年度

会计师事务所、公司会计师、审计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、公司律师	指	北京市盈科（无锡）律师事务所
集成电路（Integrated Circuit，简称“IC”）	指	将一个电路的大量元器件集合于一个单晶片上所制成的器件。集成电路制造商采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor，中文为“互补金属氧化物半导体”。即由 PMOS 和 NMOS 晶体管组合而成的半导体电路，因其低功耗和集成度高，成为当今主流的集成电路构成方式。其制造工艺被称为 CMOS 工艺。
晶圆、圆片	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称为晶圆；在硅晶片上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能之 IC 产品。
布图、版图	指	确定用以制造集成电路的电子元件在一个传导材料中的几何图形排列和连接的布局设计。
掩膜	指	又称 Mask、光罩、光掩膜，即半导体制造中用于光刻技术的图形“底片”，通常为制造流程中造价最高的部分。
封装	指	将硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。
Fabless 模式	指	即无生产线设计公司模式，采用该模式的 IC 设计公司自身不具备晶圆制造和封装生产线，专

		注于技术和工艺研发，将生产环节全部外包。
IDM 模式	指	IDM 是英文 Integrated Device Manufacture 的缩写，即垂直集成模式。其特点是企业经营范围覆盖芯片设计、生产制造、封装测试各环节。
SoC	指	System on Chip 的缩写，称为芯片级系统，意指它是一个产品，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。
钳位	指	将某点的电位限制在规定电位的措施，叫做钳位。
偏置	指	在电子学上是指在电子电路上的多个点中，通过建立预定电压和/或电流从而设置某个适当的工作点的方法。
1080i/1080p	指	高清晰度的电视信号格式
LED	指	白光发光二极管
USB	指	USB 是应用在 PC 领域的接口技术，USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能。
锁相环	指	指一种电路或者模块，它用于通信的接收机中，其作用是对接收到的信号进行处理，并从其中提取某个时钟的相位信息。
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示屏，具有体积小，重量轻、能耗少、无辐射等优点。
AB 类功率放大器	指	也称“甲乙类功率放大器”，是兼容 A 类与 B 类功放优势的一种设计。当没有信号或信号非常小时，晶体管的正负通道都常开，这时功率有所损耗，但没有 A 类功放严重。当信号是正相时，负相通道在信号变强前还是常开的，但信号转强则负通道关闭。当信号是负相时，正负通道的工作刚好相反。AB 类功率放大器可以避免交越失真。交替失真较大，可以抵消偶次谐波失真。有

		效率较高，晶体管功耗较小的特点。
D 类放大器	指	AB 类放大器有很大的功耗，D 类放大器采用了不同于 AB 类的拓扑结构，输出级在正电源和负电源之间切换从而产生一串电压脉冲，这种波形有利于降低功耗。
THD	指	Total Harmonic Distortion，总谐波失真。
耦合电容	指	用在耦合电路中的电容称为耦合电容，在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路，起隔直流通交流作用。
自举电容	指	用在自举电路中的电容器称为自举电容，以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
I/O	指	Input/Output，电子设备的输入/输出装置。
振荡器	指	用来产生重复电子讯号（通常是正弦波或方波）的电子元件，其构成的电路叫振荡电路，能够将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置。
微控制单元	指	Micro Control Unit，简称“MCU”，又称单片微型计算机(Single Chip Microcomputer)或者单片机，是指随着大规模集成电路的出现及其发展，将计算机的 CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种 I/O 接口集成在一片芯片上，形成芯片级的计算机，为不同的应用场合做不同组合控制。
摩尔定律	指	集成电路行业的一种现象，即集成电路设计技术每 18 个月就更新换代一次。
$\mu\text{m}$	指	微米，长度单位，1 微米= 0.001 毫米。
华润上华科技	指	无锡华润上华科技有限公司
天水华天	指	天水华天科技股份有限公司
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部

## 第一节 基本情况

### 一、公司基本情况

公司名称：无锡汉咏微电子股份有限公司

英文名称：Wuxi Herochip Microelectronics Co., Ltd

注册资本：500 万元

法定代表人：郑云华

有限公司成立日期：2010 年 2 月 25 日

股份公司成立日期：2013 年 12 月 23 日

住所：无锡新区长江路 21-1 号无锡国家集成电路设计园（创源大厦）207-2 室

邮编：214028

组织机构代码：55118402-9

登记机关：无锡工商行政管理局

电话号码：0510-85898862

传真号码：0510-84060007

网站地址：<http://www.herochip.cn/>

公司邮箱：[herochip@herochip.cn](mailto:herochip@herochip.cn)

董事会秘书：韩基东

所属行业：根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订版）规定，公司所处行业为 C39-计算机、通信和其他电子设备制造业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处行业为 C39-计算机、通信和其他电子设备制造业。

主营业务：集成电路芯片的设计、销售

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：集成电路芯片的设计、销售、技术服务、技术转让；电子产品的开发和销售

### 二、股票挂牌情况

#### （一）挂牌情况

股票代码：【】

股票简称：【】

股票种类：人民币普通股

每股面值：1.00 元

股票总量：5,000,000 股

挂牌日期：2014 年【】月【】日

## （二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

### 1、相关法律法规及《公司章程》对股份转让的限制

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。”

《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章 2.8 规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股份的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《公司章程》第二十九条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报

所持有的公司的股份及变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。”

2、挂牌日公司各股东可转让的股份情况如下：

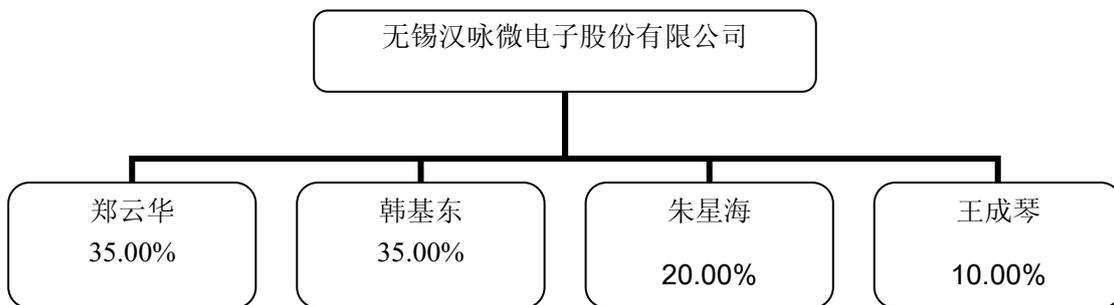
股东	持股数量 (股)	任职情况	股份是否 冻结、质押	本次可公开转让 股份数量(股)
郑云华	1,750,000.00	董事长、总经理	否	0
韩基东	1,750,000.00	副总经理、董事会秘书	否	0
朱星海	1,000,000.00	董事	否	0
王成琴	500,000.00	监事会主席	否	0
合计	5,000,000.00			0

除上述情形外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。

### 三、公司股权结构及股东情况

#### (一) 股权结构

序号	股东姓名	持股数(股)	持股比例(%)
1	郑云华	1,750,000.00	35.00
2	韩基东	1,750,000.00	35.00
3	朱星海	1,000,000.00	20.00
4	王成琴	500,000.00	10.00
合计		5,000,000.00	100.00



#### (二) 实际控制人和主要股东情况

##### 1、公司股东名单

股东姓名	持有股份（股）	持股比例（%）	股份性质
郑云华	1,750,000.00	35.00	自然人股
韩基东	1,750,000.00	35.00	自然人股
朱星海	1,000,000.00	20.00	自然人股
王成琴	500,000.00	10.00	自然人股
合计	5,000,000.00	100.00	

公司股东之间均无关联关系。

## 2、实际控制人基本情况及实际控制人认定情况

公司实际控制人为郑云华与韩基东二人。

郑云华，男，满族，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月毕业于吉林大学微电子专业，获得本科学历；1999年7月—2002年1月，任大连连顺电子有限公司工程师；2002年2月—2008年7月，任摩托罗拉/飞思卡尔电子有限公司资深工程师；2008年8月—2009年12月，任无锡友芯集成电路设计有限公司副总经理；2010年2月—2013年12月，任有限公司总经理；2013年12月至今，任股份公司董事长、总经理。

韩基东，男，汉族，1975年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，1998年7月毕业于辽宁工学院通信工程专业，获得本科学历；1998年7月—1999年6月，任大连奥瑞电子有限公司工程师；1999年7月—2002年1月，任大连连顺电子有限公司工程师；2002年2月—2010年9月，任无锡友达电子有限公司部门经理，在友达电子有限公司工作期间攻读东南大学工程硕士，于2010年获得研究生学历；2010年10月—2013年12月，任有限公司副总经理；2013年12月至今，任股份公司副总经理、董事会秘书。

郑云华与韩基东各持有股份公司175万股，共计持有公司股份350万股，两人各自持有公司股权比例为35%，合计持有公司股权的比例为70%。报告期内，两人合并直接持有公司股权的比例在公司股东中位列第一。郑云华担任公司董事长、总经理，韩基东则担任公司董事、董事会秘书、副总经理，对公司股东大会、董事会的重大决策和公司经营活动能够产生重大影响；郑云华、韩基东两人基于共同的利益基础和共同认可的公司发展目标，彼此信任，历史上合作关系良好，在公司所有重大决策上均在事前充分沟通的基础上达成了一致意见，事实上构成

了对公司经营上的共同控制。同时，根据公司实际运作情况以及郑云华、韩基东两人于 2014 年 3 月 18 日共同签署《一致行动协议书》，认定郑云华、韩基东两人为公司的共同实际控制人。

### 3、控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至本说明书签署日，公司控股股东、实际控制人郑云华、韩基东没有控制其他企业。

### 4、其他主要股东基本情况

朱星海，男，汉族，1979 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 7 月毕业于扬州大学电子专业，获得本科学历；1999 年 7 月—2004 年 1 月，任深圳友顺利电子有限公司销售经理；2004 年 2 月至今，任深圳玖泰电子有限公司业务经理。

王成琴，女，汉族，1967 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 7 月—2010 年 1 月，就职于天水华天科技股份有限公司，1997 年 9 月—2000 年 12 月毕业于西北师范大学计算机应用专业，获得大专学历。2010 年 2 月—2013 年 8 月，就职于无锡颐鼎科技有限公司。2013 年 9 月退休。2013 年 12 月至今，任股份公司监事会主席。

### 5、股份质押和其他有争议情况

截至本说明书签署日，公司所有股东持有的公司股份不存在质押和其他争议事项的情况。

## 四、公司股本演变情况

### （一）有限公司的设立（2010 年 2 月 25 日）

无锡汉咏微电子股份有限公司由郑云华、叶叶夫妇共同出资设立。设立时注册资本为人民币 200 万元，实缴资本 100 万元。2010 年 2 月 24 日，无锡泰伯联合会计师事务所（普通合伙）出具锡泰伯（2010）验字 0323 号验资报告审验确认有限公司注册资本为人民币 200 万元，实缴资本人民币 100 万元。

2010年2月25日，无锡工商行政管理局新区分局向无锡汉咏微电子有限公司核发了《企业法人营业执照》，注册号码为：320213000127484。住所：无锡新区长江路21-1号无锡国家集成电路设计园（创源大厦）207-2室，法定代表人：郑云华。注册资本：200万元人民币。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：集成电路芯片的设计、销售、技术服务、技术转让；电子产品的开发和销售。

有限公司设立时各股东出资情况如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资方式	出资比例	设立时缴付金额（万元）
郑云华	100.00	货币	50.00%	50.00
叶叶	100.00	货币	50.00%	50.00
合计	200.00		100.00%	100.00

### （二）有限公司第一次股权转让（2010年5月24日）

2010年4月19日，有限公司召开股东会并决议同意，股东郑云华将其持有的有限公司25%的股份（计50万股）以50万元的价格转让给张滢清，股东叶叶将其持有的有限公司25%的股份（计50万股）以50万元的价格转让给张滢清。本次变更已于2010年5月24日在无锡工商行政管理局新区分局办理了变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	转让前		转让后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
郑云华	100.00	50.00%	50.00	25.00%
叶叶	100.00	50.00%	50.00	25.00%
张滢清	-	-	100.00	50.00%
合计	200.00	100.00%	200.00	100.00%

### （三）有限公司第二次股权转让（2010年11月25日）

2010年11月10日，有限公司召开股东会并决议同意，股东郑云华将其持有的有限公司5%的股份（计10万股）以10万元的价格转让给张若南，股东叶叶将其持有的有限公司20%的股份（计40万股）以40万元的价格转让给韩基东；股东叶叶将其持有的有限公司5%的股份（计10万股）以10万元的价格转让给赵云午。本次变更已于2010年11月25日在无锡工商行政管理局新区分局办理了变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	转让前		转让后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
郑云华	50.00	25.00%	40.00	20.00%
叶 叶	50.00	25.00%	-	-
张滢清	100.00	50.00%	100.00	50.00%
韩基东	-	-	40.00	20.00%
张若南	-	-	10.00	5.00%
赵云午	-	-	10.00	5.00%
合 计	200.00	100.00%	200.00	100.00%

#### （四）有限公司第一次增资（2011年9月8日）

2011年9月6日，有限公司召开股东会决议一致同意将公司注册资本由200万元人民币增至250万元人民币，本次50万元增资部分由郑云华出资25万元人民币，韩基东出资25万元人民币。上述增资经无锡泰伯联合会计师事务所（普通合伙）出具锡泰伯（2011）增字079号验资报告审验确认，并于2011年9月8日在无锡工商行政管理局新区分局完成了相应的变更登记，换发了新的营业执照。本次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
郑云华	40.00	20.00%	65.00	26.00%
张滢清	100.00	50.00%	100.00	40.00%
韩基东	40.00	20.00%	65.00	26.00%
张若南	10.00	5.00%	10.00	4.00%
赵云午	10.00	5.00%	10.00	4.00%
合 计	200.00	100.00%	250.00	100.00%

#### （五）有限公司第二次增资（2011年10月20日）

2011年10月10日，有限公司召开股东会决议一致同意将公司注册资本由250万元人民币增至300万元人民币，本次50万元增资部分由郑云华出资25万元人民币，韩基东出资25万元人民币。上述增资经无锡泰伯联合会计师事务所（普通合伙）出具锡泰伯（2011）增字086号验资报告审验确认，并于2011年10月20日在无锡工商行政管理局新区分局完成了相应的变更登记，换发了新的营业执照。本次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	增资前	增资后
------	-----	-----

	出资金额（万元）	出资比例	出资金额万元）	出资比例
郑云华	65.00	26.00%	90.00	30.00%
张滢清	100.00	40.00%	100.00	33.34%
韩基东	65.00	26.00%	90.00	30.00%
张若南	10.00	4.00%	10.00	3.33%
赵云午	10.00	4.00%	10.00	3.33%
<b>合 计</b>	<b>250.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （六）有限公司第三次股权转让（2011年11月14日）

2011年11月10日，有限公司召开股东会并决议同意，股东张滢清将其持有的有限公司15%的股份（计45万股）以45万元的价格转让给韩基东；股东张滢清将其持有的有限公司15%的股份（计45万股）以45万元的价格转让给郑云华；股东张滢清将其持有的有限公司3.34%的股份（计10万股）以10万元的价格转让给王成琴。股东张若南将其持有的有限公司3.33%的股份（计10万股）以10万元的价格转让给王成琴；股东赵云午将其持有的有限公司3.33%的股份（计10万股）以10万元的价格转让给王成琴。张滢清因自身健康原因转让其持有的有限公司全部股权，本次股权转让的出让方和受让方均为各方真实意思表示。本次变更已于2011年11月14日在无锡工商行政管理局新区分局办理了变更登记。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：

股东名称	转让前		增资后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
郑云华	90.00	30.00%	135.00	45.00%
张滢清	100.00	33.34%	-	-
韩基东	90.00	30.00%	135.00	45.00%
张若南	10.00	3.33%	-	-
赵云午	10.00	3.33%	-	-
王成琴	-	-	30.00	10.00%
<b>合 计</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>300.00</b>	<b>100.00%</b>

#### （七）有限公司第三次增资（2012年7月25日）

2012年7月23日，有限公司召开股东会决议一致同意将公司注册资本由300万元人民币增至400万元人民币，本次100万元增资部分由郑云华出资5万元人民币，韩基东出资5万元人民币，王成琴出资10万元人民币，新增股东朱星海出资80万元人民币。上述增资经无锡泰伯联合会计师事务所（普通合伙）出具

锡泰伯（2012）增字 023 号验资报告审验确认，并于 2012 年 7 月 25 日在无锡工商行政管理局新区分局完成了相应的变更登记，换发了新的营业执照。本次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
郑云华	135.00	45.00%	140.00	35.00%
韩基东	135.00	45.00%	140.00	35.00%
王成琴	30.00	10.00%	40.00	10.00%
朱星海	-	-	80.00	20.00%
合计	300.00	100.00%	400.00	100.00%

#### （八）有限公司第四次增资（2013 年 10 月 24 日）

2013 年 10 月 18 日，有限公司召开股东会决议一致同意将公司注册资本由 400 万元人民币增至 500 万元人民币，本次 100 万元增资部分由郑云华出资 35 万元人民币，韩基东出资 35 万元人民币，王成琴出资 10 万元人民币，朱星海出资 20 万元人民币。上述增资经无锡泰伯联合会计师事务所（普通合伙）出具锡泰伯（2013）增字 022 号验资报告审验确认，并于 2013 年 10 月 24 日在无锡工商行政管理局新区分局完成了相应的变更登记，换发了新的营业执照。本次增资后，有限公司股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额（万元）	出资比例	出资金额（万元）	出资比例
郑云华	140.00	35.00%	175.00	35.00%
韩基东	140.00	35.00%	175.00	35.00%
王成琴	40.00	10.00%	50.00	10.00%
朱星海	80.00	20.00%	100.00	20.00%
合计	400.00	100.00%	500.00	100.00%

#### （九）、整体变更为股份有限公司（2013 年 12 月 23 日）

2013 年 11 月 23 日，有限公司召开 2013 年第二次临时股东会，决议并一致同意有限公司整体变更为股份有限公司。

开元资产评估有限公司 2013 年 11 月 22 日出具的开元评报字[2013]第 163 号《资产评估报告》，以 2013 年 10 月 31 日为评估基准日，有限公司经评估的账面净资产为人民币 553.41 万元。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2013]8-196号《审计报告》，截至2013年10月31日有限公司经审计的账面净资产为人民币5,050,557.44元。

2013年12月9日，无锡汉咏微电子股份有限公司召开创立大会暨第一次股东大会，通过了股份公司章程，选举第一届董事会成员和第一届监事会成员。

2013年12月13日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验[2013]8-31号验资报告，对股份公司各发起人股东的出资情况审验确认，有限公司净资产中的5,000,000.00元，折合公司股本500万股，每股面值1元，剩余部分50,557.44元计入资本公积。全体股东作为发起人，以净资产折股出资。股份公司的股权结构如下：

股东名称（姓名）	持股数量（股）	持股比例	出资方式
郑云华	1,750,000.00	35.00%	净资产
韩基东	1,750,000.00	35.00%	净资产
朱星海	1,000,000.00	20.00%	净资产
王成琴	500,000.00	10.00%	净资产
合计	5,000,000.00	100.00%	

2013年12月23日，无锡工商行政管理局出具《公司准予变更登记通知书》，公司正式更名为无锡汉咏微电子股份有限公司，并取得注册号为320213000127484的《企业法人营业执照》。经营范围为许可经营项目：无；一般经营项目：集成电路芯片的设计、销售、技术服务、技术转让；电子产品的开发和销售。

## 五、公司设立以来重大资产重组情况

公司成立以来，未发生任何重大资产重组情形。

## 六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况

### （一）公司董事

姓名	职务	任职期限
郑云华	董事长兼总经理	2013年12月至2016年12月

韩基东	董事、董事会秘书兼副总经理	2013年12月至2016年12月
朱星海	董事	2013年12月至2016年12月
白宇	董事	2013年12月至2016年12月
叶叶	董事	2013年12月至2016年12月

上述董事简历如下：

1、郑云华，董事长兼总经理，任期自2013年12月至2016年12月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

2、韩基东，董事、董事会秘书兼副总经理，任期自2013年12月至2016年12月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

3、朱星海，董事，任期自2013年12月至2016年12月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

4、白宇，董事，任期自2013年12月至2016年12月止。男，汉族，1985年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于沈阳药科大学，获得大专学历。2007年8月—2010年6月任大连美罗药业有限公司业务经理；2010年7月—2013年12月，任有限公司运营部经理；2013年12月至今，任股份公司董事，同时任股份公司运营部经理。

5、叶叶，董事，任期自2013年12月至2016年12月止。女，汉族，1979年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年7月毕业于辽宁仪器仪表学院，获得大专学历。1999年7月—2002年1月，任大连连顺电子有限公司工程师；2002年2月—2008年8月，任天津中晶微电子有限公司工程师；2008年9月—2009年12月，任无锡友芯集成电路设计有限公司工程师；2010年2月—2012年2月任无锡中科芯集成电路股份有限公司工程师；2013年12月至今，任公司董事。

## (二) 公司监事

姓名	职务	任职期限
王成琴	监事会主席	2013年12月至2016年12月
朱舰	监事	2013年12月至2016年12月

吴彩虹	职工监事	2013年12月至2016年12月
-----	------	-------------------

上述监事简历如下：

1、王成琴，监事会主席，任期自2013年12月至2016年12月止。详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

2、朱舰，男，汉族，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于无锡职业技术学院，获得大专学历。2010年7月—2013年12月任有限公司部门经理；2013年12月至今任股份公司监事，同时任股份公司设计三部经理。

3、吴彩虹，女，汉族，1986年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于无锡职业技术学院，获得大专学历。2010年7月—2013年12月任有限公司部门经理；2013年12月至今任股份公司职工监事，同时任股份公司设计二部经理。

### (三) 公司高级管理人员

姓名	职务	任职期限
郑云华	董事长兼总经理	2013年12月至2016年12月
韩基东	董事、副总经理、董事会秘书	2013年12月至2016年12月
戴琴莎	财务总监	2013年12月至2016年12月

上述高级管理人员简历如下：

1、郑云华，董事长兼总经理，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

2、韩基东，董事、副总经理兼董事会秘书，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

3、戴琴莎，财务总监，女，汉族，1990年1月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010年7月毕业于南京审计学院会计专业，获得大专学历。2010年7月—2011年7月任无锡英骏电子有限公司会计；2011年8月—2013年12月，任有限公司财务，2013年至今任股份公司财务总监。

**(四) 董事、监事、高级管理人员的持股情况**

姓名	担任职务	持股数量（股）	持股比例
郑云华	董事长兼总经理	1,750,000.00	35.00%
韩基东	董事、副总经理、董事会秘书	1,750,000.00	35.00%
朱星海	董事	1,000,000.00	20.00%
白 宇	董事	-	-
叶 叶	董事	-	-
王成琴	监事会主席	500,000.00	10.00%
朱 舰	监事	-	-
吴彩虹	职工监事	-	-
戴琴莎	财务总监	-	-
<b>合计</b>		<b>5,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

目前全体股东持有的股份公司股份完全真实合法，且历史上不存在任何代持行为。

**七、最近两年主要财务数据及财务指标**

财务指标	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	1,033.29	560.51
股东权益合计（万元）	528.32	397.46
归属于申请挂牌公司股东的权益合计（万元）	528.32	397.46
每股净资产（元/股）	1.06	0.99
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	0.99
资产负债率（%）	48.87	29.09
流动比率（倍）	1.95	3.00
速动比率（倍）	1.50	1.15
财务指标	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,364.83	1,047.07
净利润（万元）	30.86	11.24
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	30.86	11.24
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-49.89	5.48
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-49.89	5.48
毛利率（%）	17.20	18.71
净资产收益率（%）	7.18	3.37
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-11.61	1.64
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03
应收账款周转率（次）	6.97	7.72

存货周转率（次）	4.53	3.87
经营活动产生的现金流量净额（万元）	28.97	-6.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-0.02

## 八、本次挂牌相关的机构

### （一）主办券商

名称：国联证券股份有限公司

法定代表人：姚志勇

住所：无锡市金融一街 8 号

联系电话：0510-82790313

传真：0510-82833627

项目小组负责人：张浩

项目小组成员：陆茜、方红涛、惠宇、杨春柳、张倩

### （二）律师事务所

名称：北京市盈科（无锡）律师事务所

负责人：徐磊

住所：无锡市滨湖区太湖西大道 1188-2 号润华国际大厦 60 层

联系电话：0510-81833286

传真：0510-81833287

项目负责人：薛孝东

签字律师：薛孝东、居红军

### （三）会计师事务所

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

法定代表人：胡少先

住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼

联系电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

项目负责人：龙文虎、唐明

签字注册会计师：龙文虎、唐明

#### **（四）资产评估机构**

名称：开元资产评估有限公司

法定代表人：胡劲为

住所：北京市海淀区中关村南大街 18 号军艺大厦 B 座 15 层

联系电话：010-62166150

签字注册资产评估师：范玉坤、张佑民

#### **（五）证券登记结算机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

联系电话：010-58598980

传真：010-58598977

#### **（六）证券交易场所**

名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

法定代表人：杨晓嘉

住所：北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦

联系电话：010-63889512

传真：010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司业务情况

#### (一) 主营业务

无锡汉咏微电子股份有限公司是一家专业从事大规模 SoC 数模混合芯片设计的高科技创新企业，总部位于江苏省无锡市国家集成电路设计园内。公司成立于 2010 年，专注于集成电路芯片的设计和 sales，为客户提供性价比高、品质稳定的集成电路产品。

#### (二) 主要产品及其用途

公司产品主要包括车载电子视频驱动芯片、电脑 USB 外设接口芯片、音频功放驱动芯片以及 LED 照明驱动芯片，广泛应用于消费类电子、物联网、汽车电子、工业控制等领域。

公司产品具体应用领域如下：

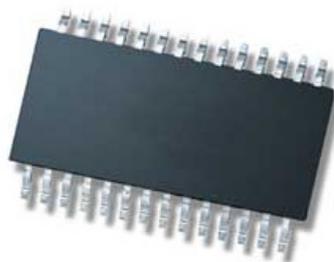
车载电子	USB 外设	音频功放	LED 驱动	其他领域
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 视频开关</li> <li>• 背光驱动</li> <li>• 马达伺服</li> <li>• 音频 CODEC</li> <li>• CAN Bus 主控</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB Audio</li> <li>• USB Hub 2.0</li> <li>• USB 键盘</li> <li>• USB to 以太网</li> <li>• MHL to HDMI</li> <li>• USB 3.0 主控</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3W AB 类功放</li> <li>• 3W D 类功放</li> <li>• 3W F 类功放</li> <li>• 5W F 类功放</li> <li>• 10W F 类功放</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3W 驱动</li> <li>• 7W 以上驱动</li> <li>• 3W 调光电路</li> <li>• 18W PFC 驱动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 高速 AD/DA</li> <li>• 模拟开关</li> <li>• 智能卡驱动</li> <li>• MCU 单片机</li> </ul>

#### 1、车载电子视频驱动芯片

##### (1) HY005（8 输入、6 输出视频开关）

HY005 提供 8 个可任意连接到 6 个输出的输入端口，支持单对单或者段对多的输入到输出的配置，输入到输出线路和输入偏置模式功能受 I<sup>2</sup>C（一种总线结构）兼容数字接口控制，主要应用于车载中控屏的视频切换。HY005 的输入提供钳位或偏置选项，以便处理同步或非同步的视频信号。HY005 支持标准清晰度（SD）、逐行扫描（PS）和高清晰度（HD）1080i/1080p 的视频信号。每个输出可以提供

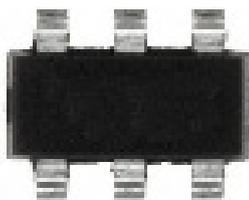
0dB或6dB的信号增益。



## (2) HY008 (1.3A固定频率白光LED驱动器)

HY008是一个升压转换器，设计由一个5V电源为一个多达39个LED（13串LED，每串3个）的系统供电，主要应用于车载仪表背光驱动。HY008采用一种固定频率架构的电流模式来调节LED电流，通过一个外部电流检测电阻测量，HY008内带欠压锁定，在输出过载时通过电流限制和热过载来保护转换器，防止损坏。它104mV的低反馈电压能降低功率损耗，提高效率。

HY008采用小体积6引脚TSOT-23（薄小外形晶体管封装技术）封装。

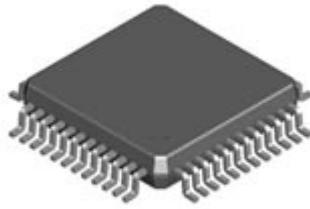


## 2、电脑USB外设接口芯片

### (1) HY001（高集成USB音频I/O控制器）

HY001是一种高度集成的单芯片USB音频解决方案。所有重要的模拟模块均嵌入HY001，包括DAC（Digital to Analog Converter，双数模转换器）和耳机驱动器、ADC（Analog to Digital Converter，数模转换器）、麦克风扩音器、锁相环、稳压器和USB收发器。

HY001主要应用于USB耳机或USB音频接口盒。音频可通过HID（Home information Display，家庭信息显示器）兼容的音量控制引脚调节。此外，外部解码器或音频DSP（Digital Signal Processing，数字信号处理）可以通过连接到HY001的I<sup>2</sup>S引脚作进一步处理。4个GPIO（General Purpose Input Output，通用输入/输出）引脚可与客户附加的应用软件通信，兼容Win 98的SE/Win ME/Win 2000/WinXP以及无需额外驱动的Mac OS 9/OS X。HY001采用48脚LQFP（薄型四方扁平式封装技术）封装。



### 3、音频功放驱动芯片

#### (1) HY002 (3W无滤波器D类立体声音频功率放大器)

HY002是一款3W立体声D类音频功率放大器并具有64位数字音量控制，能够以D类放大器的效率提供AB类功率放大器的性能。新型的无滤波器结构可以省去传统的D类放大器输出低通滤波器，从而节省了30%系统成本和75%PCB (Printed circuit board, 印刷电路板) 空间，而数字音量控制保证了HY002的功放声音较好，是便携式应用的理想选择。

产品主要应用于便携式扬声器和便携式DVD播放器。HY002采用SSOP-24 (缩小型外形封装技术) 封装。

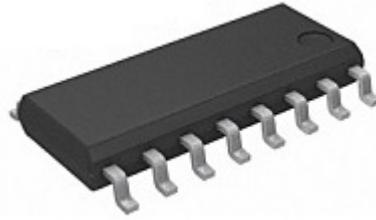


#### (2) HY009 (双通道带立体声耳机模式的音频功率放大器)

HY009是一个双路音频功率放大器，它能够在5V电源电压下给一个4 $\Omega$ 负载提供THD (Total Harmonic Distortion, 总谐波失真) 小于1%、最大平均值为2.2W的输出功率。另外，在驱动立体声耳机时耳机输入引脚可以使放大器工作在单边模式。

HY009是为提供高保真音频输出而专门设计的，它仅仅需要少量的外围元件，为了简化音频系统设计，HY009集双路桥式扬声器放大器和立体声耳机放大器于一体。HY009还有外部控制的关闭模式，立体声耳机放大器模式和热保护关闭模式，还有减少开机噪声功能。

产品主要应用于手提电脑、台式电脑、多媒体监视器、便携式视频系统。



### (3) HY021 (3W带关闭模式的音频功率放大器)

HY021是一个单通道3W、BTL桥连接的音频功率放大器。它能够在5V电压、4 Ω负载的条件下工作，提供THD (Total Harmonic Distortion, 总谐波失真) $<10\%$ 、平均值为3W输出功率。

HY021是为提供大功率，高保真音频输出而专门设计的。极少的外部元件从而简化了线路设计、节省了电路板空间、降低了生产成本，并且能在低电压条件下(2.0V-5.5V)工作。HY021不需要耦合电容、自举电容或者缓冲网络，所以它非常适用于小音量和低重量的低功耗系统中。

产品主要应用于MINI音箱、对讲门铃以及语音玩具等。HY021采用SOP-8 (小外形封装技术) 无铅封装。



## 4、LED照明驱动芯片

### (1) HY007 (高精度原边反馈LED恒流控制芯片)

HY007是一款高精度原边反馈的LED恒流控制芯片。适用于输入全电压范围的反激式隔离LED恒流电源。

HY007工作在电感电流断续模式，采用原边反馈模式，无需次级反馈电路，也无需补偿电路即可实现恒流，极大的节约系统成本和体积。芯片采用了恒流控制方式，可以达到优异的线性调整率和负载调整率。

HY007内带有高精度的电流取样电路，使得LED输出电流精度达到 $\pm 3\%$ 以内。具有多重保护功能，包括LED开路保护、LED短路保护、芯片过温保护，过压保护，欠压保护，FB (Feedback, 反馈脚) 短路保护等。

HY007主要运用于GU10 (两个插脚柱的中心距离是10mm的灯头) /E27 (螺

纹口直径27mm的螺旋灯头), LED球泡灯、射灯, LED PAR30/PAR38 (抛物面反射形的灯)、桶灯, LED日光灯及其它LED照明, 可直接与220V电源连接, 无需外接电源转换器。HY007采用小体积 SOT23-5 (小外形晶体管) 封装。

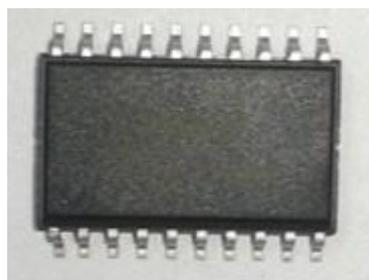


## 5、其他领域

### (1) RN5510 (高速8位AD转换器)

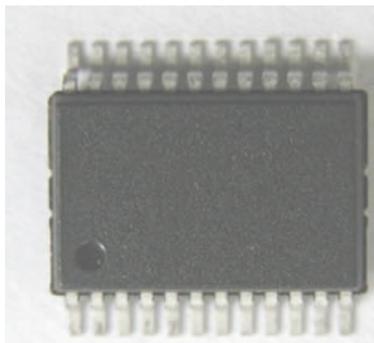
RN5510 是 CMOS 工艺制造的 8 位 20MSPS (Million Samples per Second, 模拟混合信号转换速率) 模拟数字转换器 (ADC), 它利用了半闪速结构。RN5510 用单 5V 电源工作且只消耗 130mW 的功率。它还包含有内部采样和保持电路, 具有高阻抗方式的并行口以及内部基准电阻。与闪速转换器相比, 半闪速结构减少了功率损耗和芯片尺寸。通过在过程中实现转换, 可大大减少比较器的数目。内部基准电阻使用 VDDA (模拟电源) 可产生标准的 2V 满度转换范围。为了实现此选项仅需外部跳线器, 减少了对外部基准或电阻器的需求。

RN5510主要应用于安防视频监控、数字电视、医学图象、可视会议、高速数据转换和QAM (Quadrature Amplitude Modulation, 正交振幅调制) 解调。



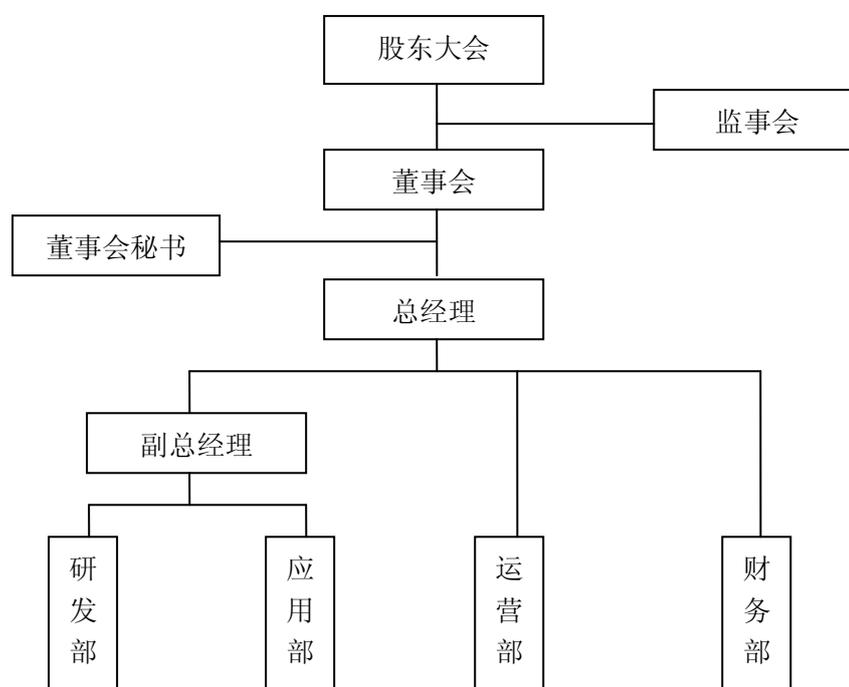
### (2) RN5602 (高速8位数模转换器)

RN5602 是 1 $\mu$ m 工艺的低功率、超高速视频数模转换器。RN5602 以从 DAC (Digital to Analog Converter, 数模转换器) 至 20MHz 的取样速度将数字信号转换成模拟信号。由于高速工作, RN5602 适合于数字电视、电脑视频处理及雷达信号处理等数字视频应用。



## 二、公司生产或服务的主要流程及方式

### (一) 公司组织架构图



### (二) 公司主要业务流程

#### 1、业务流程

集成电路行业企业通常根据其在 IC 产业链的不同环节，分为 IC 设计、IC 制造和 IC 封装测试三类企业。在集成电路行业中，IC 设计是第一个环节，位于产业链的上游，属于智力密集型行业，是需要具有较高技术含量和创新实力的环节；IC 制造环节为生产制造晶圆基片并将设计环节设计好的电路版图蚀刻在晶圆基片上，属资金、技术密集型行业，该环节投资巨大，通常一条晶圆生产线需要投资数亿美元；IC 封装及测试为后段加工环节，资金及技术门槛相对较低。

集成电路产业链具体业务流程为：

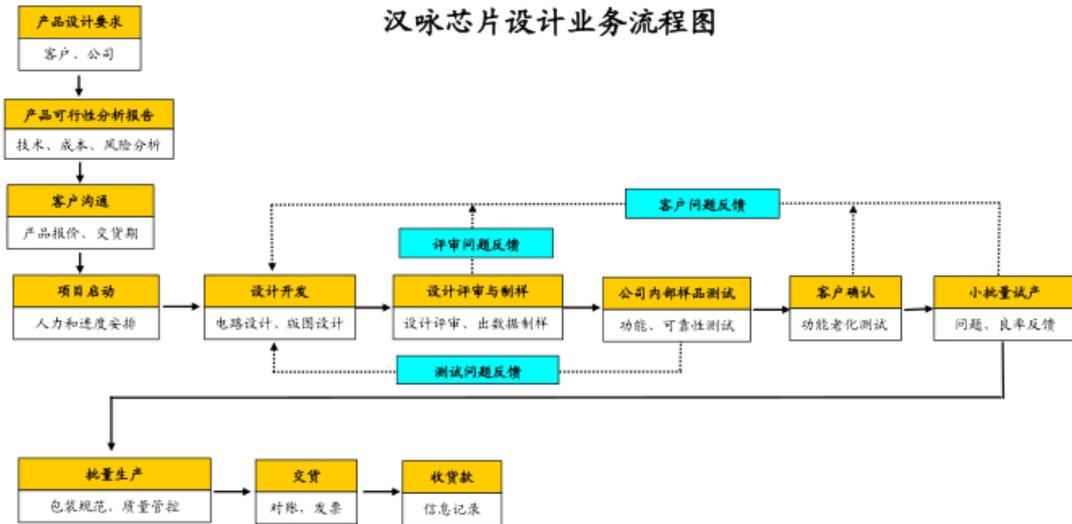


晶圆代工指根据企业的 IC 设计，将设计数据分次刻录在晶圆上，收取代工费。封装测试企业将制作好的晶圆进行切割并封装形成最终 IC 产品，经过测试后将合格品交付设计企业，并收取相应加工费用。从生产流程上来看，IC 设计企业根据终端电子产品需求进行集成电路布图设计，并委托厂商进行晶圆代工，芯片封装测试，待芯片完成生产后，交付经销商或者直接交付终端电子厂商进行应用。

公司作为集成电路行业中的无生产线（Fabless）设计企业，所有量产产品均通过委托加工方式实现，所以公司产品实现流程包括产品研发、委托加工、销售三个环节。公司从事产品研发及技术人员包括研发部设计人员 9 人、应用部质量控制人员 3 人，从事产品的研发并对产品质量进行控制；公司销售人员 1 人，负责同经销商保持稳定的合作关系，并通过对经销商进行反馈信息收集，使公司能够更全面掌握市场变化并分析了解终端客户的需求。

## 2、设计流程

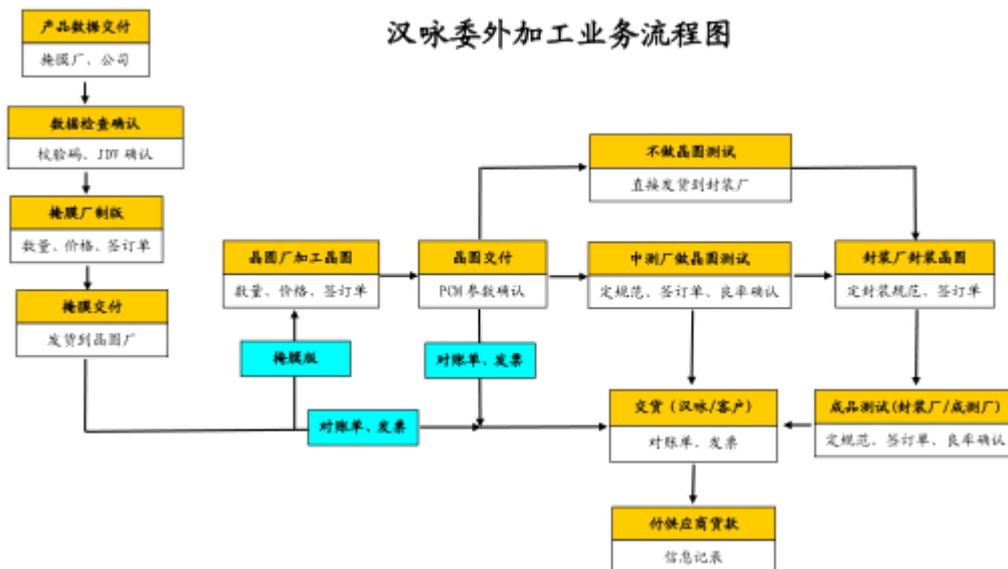
公司根据终端产品市场需求，首先通过对客户需求分析，定义产品的参数、功能和性能指标；其次，由公司负责新品设计和开发的副总经理组织对产品定义及其市场竞争力、工艺可行性、系统设计可行性进行评估和评审，评审通过后下达设计任务书并制定新品设计的阶段计划表；再次，设计组按照设计阶段计划表中规定的职责分工、各阶段工作内容和时间节点要求，完成新品的电路设计，包括线路（逻辑）设计和版图设计，然后由工艺负责人与项目负责人、根据对产品具体参数的要求选择委托加工的工艺平台，同时公司研发人员进行电路设计，将其转化为集成电路版图数据。具体研发流程图如下：



## 2、生产和采购流程

在生产和采购环节，公司采用了代工生产模式，即将集成电路的晶圆生产、芯片制造、封装测试外包，专注于集成电路设计。因此，公司的生产和采购流程主要包括晶圆采购、封装测试等委托加工环节。晶圆代工厂商根据公司的 IC 设计，向公司提供加工完成的晶圆；封装测试企业将制作好的晶圆进行切割并封装形成最终 IC 产品。

具体的流程如下：



公司运营部与选定的供应商签订圆片加工或封装测试合同，合同内容包括进度、交付期、交付要求、价格、付款条件、售后服务、违约责任等，供应商根据

公司提供的技术文件对产品进行圆片加工或封装、测试工作。同时，公司也与供应商签订质量保证协议，规定圆片加工或封装测试的技术要求、质量要求、验收内容、方法及相关标准、产品更改控制要求等作为合同的附件。公司通过应用部对供应商的加工质量进行及时监控，如果供应商对关键原材料、关键设备、关键工艺、出厂检验规范等进行更改，应得到公司应用部的试验、验证、评审并答复同意后方可进行。公司会根据产能瓶颈、封装形式、价格、加工交货期等综合因素实施调整供应商加工量的分配。

### 3、销售流程

公司销售以经销商代理销售为主、直接销售为辅的模式销售产品，并与主要经销商建立了稳定合作关系。在集成电路行业中，IC 产品种类繁多，可以应用于广泛的终端行业，客户规模大小不一，通过引入经销商销售的方式，不仅能够增强公司的销售能力，而且通过对经销商进行反馈信息收集，公司能够更全面掌握市场变化并分析了解终端客户的需求，在此基础上更新现有产品和设计、研发新产品。

公司制定经销商管理制度，规定了包括经销商选拔、对经销商经营方面的管理、与经销商交易活动的管理、经销商档案管理、经销商培训以及对经销商整顿与淘汰的具体规则与流程。

公司在选拔经销商时，由运营部填写“经销商评估表”，并由公司总经理审批确定合作的经销商。公司运营部应该给每个经销商建立“经销商评估表”，每半年更新一次，并由公司存档。经销商的经营状况和信用状况发生比较大变化时，应该随时予以更新。公司与经销商的所有电话，都应做记录留存。公司对经销商的每次发货，每笔回款都予以记录。此外，公司定期对经销商进行培训，使经销商更明确和理解公司的营销思路和营销策略的发展变化，并从经销商的反馈中更全面的掌握市场变化并分析了解终端客户的需求，在此基础上更新现有产品和设计、研发新产品。

公司建立产品销售过程管理制度，规定客户档案管理、订单评审、订单执行、回款等工作的控制要求和工作程序，确保产品销售过程以受控方式有序地进行，完成销售目标。

公司销售立足于华南和华东地区，通过公司的业务信息渠道和良好的品牌形象，不断提升公司的营销能力。

### 三、与公司业务相关的主要资源要素

#### （一）主要产品及服务所使用的主要技术

##### 1、主要技术

公司在集成电路设计领域所应用的主要核心技术均由公司自主研发而成，具体如下：

##### （1）一种高性能运算放大器（专利号：ZL201320075912.6）

本专利提出了一种高性能的运算放大器结构，采用折叠共源共栅运放，具有套筒式运放带宽大和速度高的特点。因为它的次主极点也是由内部有源负载管的跨导和内部节点的寄生电容决定，所以它的频率特性和套筒结构相近。这种结构克服了一般结构的差动式运算放大器在条件极其恶劣的环境下，并不能明显的提高系统性能的缺陷，具有对各种干扰影响适应性强的优势，能够广泛地运用在各种音频驱动、模数转换器等芯片之中。在公司的各种车载影音驱动芯片中，应用了这种放大器结构，使该系类芯片产品的在性价比方面显著优于竞争对手。

##### （2）一种具有低压低功耗电路结构的振荡器（专利号：ZL201320080180.X）

降低系统的功耗已经成为电子产品，特别是便携设备不断追求的目标。在系统中振荡器是能量消耗的主要部件之一，低压低功耗的振荡器在 2.5V 左右的电压下工作，并且功耗在 5 $\mu$ A 以下。

振荡器几乎在每款集成电路中都有使用，它作为系统的本振时钟，产生系统需要的各种时间关系。一般内置振荡器大都在 2.5~5V 电源下工作，并且功耗在 0.1mA 左右。

鉴于产品应用的低功耗与产品成本的考虑，一种低压低功耗的振荡器电路结构成为电子产品设计的需求，公司设计了一种低压低功耗的振荡器电路结构，实现其在低压下工作，使其功耗低于 5 $\mu$ A 以下。该项专利技术广泛应用于公司芯片产品中，相对于竞争对手的产品在功耗的指标方面，公司产品具有明显竞争优

势。

### (3) 一种锗隧穿二极管（专利号：ZL201320076841.1）

随着物联网产业的发展，无线技术的应用越来越普及，而做为高速射频电路的发射器件多采用砷化镓工艺的共振二极管或用气相外延法制作的隧穿二极管结构，这两种结构具有成本高、不兼容 CMOS 工艺等缺点。

而锗隧穿二极管因具有电流密度大、工作速度快、独特的微分负阻特性和硅工艺制作技术相兼容等优点，可以广泛应用于 RF 射频电路、高速振荡器、存储器、多值逻辑电路等电路中。

本专利设计了一种基于 CMOS 工艺的锗隧穿二极管结构做为射频电路的发射极，具有兼容 CMOS 工艺、便于集成、成本低等优势，已经在公司面向物联网领域应用的 2.4G ZigBee SoC 芯片中使用了该项技术，预计 2014 年底可以投入生产。

## 2、核心技术来源及保护

公司拥有自己的研发部门、完善的研发组织及经验丰富的研发人员，每年均投入大量的人力、物力和财力进行集成电路芯片的研发和技术更新。目前，公司主要产品所采用的核心技术均为自主研发，公司的知识产权所有权人均为公司，不存在任何权属纠纷。

公司注重对核心技术的保护，对研发成熟的技术申请了知识产权保护，截至本说明书签署日，公司已有实用新型专利 3 项。这些专利广泛应用于公司的产品设计中，保障了公司产品的竞争力。每个集成电路产品设计的最终成果体现在用于集成电路制造加工的集合图形的组成上，也就是集成电路的版图，版图集中了电路、器件、工艺、封装、测试的所有信息，其形貌特征也受到专门保护，公司现拥有集成电路布图设计专有权 6 项，有效的防止了竞争对手的抄袭行为。

此外，公司还指定了专人对公司拥有的知识产权进行管理和保护，并且与重要人员签订了保密协议，明确公司与签约员工在技术保密上的责任和义务、约定了竞业限制条款。同时，公司聘请法律顾问，加强对知识产权的保护。公司在经济往来、合作研究与开发等技术、经济活动中，与对方约定了保密事项、权利和

义务以及违约的仲裁方法。如果发现保密事项受到侵害，及时通过行政或司法途径予以解决。

## （二）主要无形资产情况

截至本说明书签署日，公司的知识产权所有权人均为公司，不存在任何权属纠纷。

### 1、专利

截至本说明书签署日，公司拥有 3 项实用新型专利，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	类型	有效期限
1	一种高性能运算放大器	ZL201320075912.6	实用新型	2013.2.18-2023.2.17
2	一种具有低压低功耗电路结构的振荡器	ZL201320080180.X	实用新型	2013.2.21-2023.2.20
3	一种锗隧穿二极管	ZL201320076841.1	实用新型	2013.2.18-2023.2.17

截至本说明书签署日，公司正在申请的专利有 2 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	类型	申请日期	状态
1	一种锗隧穿二极管及其制备方法	201010180596.X	实用新型	2010.07.29	实审中
2	一种高性能运算放大器的结构	201010180587.0	实用新型	2010.07.29	实审中

### 2、集成电路布图设计专有权

公司根据《集成电路布图设计保护条例》申请并获得授权的集成电路布图设计登记证书有 6 项，布图设计权利人为无锡汉咏微电子股份有限公司。布图设计专有权的保护期为 10 年。

截至本说明书签署日，公司拥有布图设计情况：

序号	名称	类型	登记号	申请日期	首次投入商业利用日	授权公告日
1	RN5510	集成电路布图登记证书	BS.12501053.2	2012.08.11	2012.05.08	2012.10.12
2	RN5602	集成电路布图登记证书	BS.12501054.0	2012.08.11	2012.05.08	2012.10.12
3	HY028	集成电路布图登记证书	BS.13500966.9	2013.08.08	2013.03.15	2013.09.26

4	HY016	集成电路布图 登记证书	BS.13501261.9	2013.10.19	2013.08.01	2013.11.26
5	HY019	集成电路布图 登记证书	BS.12501116.4	2012.08.25	2012.06.30	2012.10.12
6	HY029	集成电路布图 登记证书	BS.13501204.X	2013.10.01	2013.08.01	2013.11.08

### 3、商标

截至本说明书签署日，公司申请的商标已获得国家工商行政管理总局商标局初步审查通过，具体如下表所示：

序号	商标	注册号	申请日期	初审日期
1		8635195	2010.09.03	2014.02.06

报告期内，公司处于发展初期，品牌意识并不强烈，且公司产品的销售主要通过经销商的渠道实现，公司产品凭借其技术和性能的优势以及较高的性价比取得经销商的青睐，公司的主要客户基本保持稳定，2013年较2012年的销售收入仍呈上升趋势，公司未取得商标权对公司产品的销售并不产生重大影响。未来随着公司业务的发展，公司将逐渐建立自主品牌，目前公司已获得了注册号为8635195的商标专用权。

### （三）业务许可资格或资质情况

#### 1、集成电路设计企业认定证书

公司现持有由中华人民共和国工业和信息化部于2011年12月2日核发的《集成电路设计企业认定证书》（编号：工信部电子认0486-20110），认定无锡汉咏微电子有限公司符合《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的有关规定，为集成电路设计企业。

该项证书仅需向地方工业和信息化主管部门报送年度审查报告，在地方工业和信息化主管部门对企业申请材料审核后，并最终上报至工业和信息化部，经公示无异议后，该项证书的有效期限即可持续有效。截至本说明书出具日，公司已向江苏省半导体行业协会提交2013年度的相关年审预审材料，现正在年审预审中。

## 2、江苏省科技型中小企业证书

公司现持有由无锡市人民政府新区管委会科技局于 2013 年 12 月 23 日颁发的《江苏省科技型中小企业证书》，证书编号：13320201KJQY000076，有效期二年。

### （四）特许经营权情况

截至本说明书签署日，公司无特许经营权。

### （五）公司主要固定资产情况

截至本说明书签署日，公司主要固定资产折旧率情况如下表所示：

资产类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
专用设备	10	5%	9.50%
通用设备	3~5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	5	5%	19.00%
模具	工作量法		

公司已经建立系统完整的固定资产管理体系，报告期内，固定资产运行和维护状况良好。

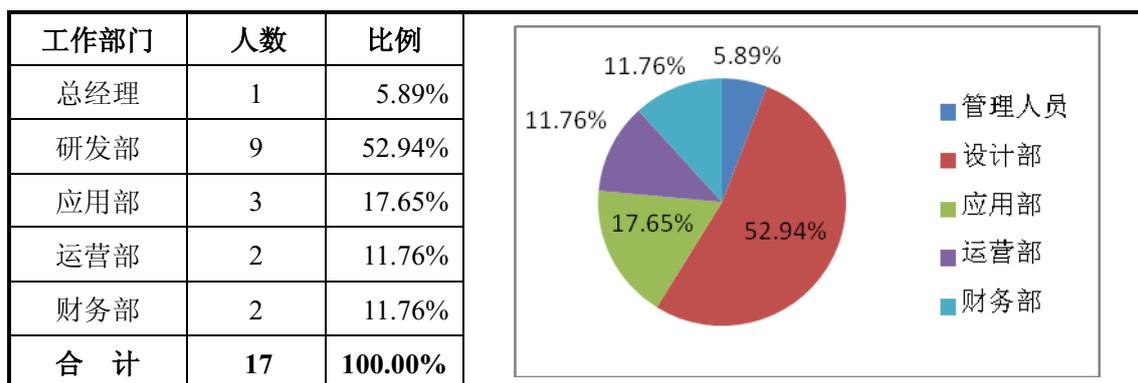
公司主要固定资产使用情况如下表所示：

2013 年 12 月 31 日	账面原值（元）	累计折旧（元）	账面价值（元）	成新率
通用设备	339,881.41	270,937.87	68,943.54	20.28%
专用设备	3,400.00	726.84	2,673.16	78.62%
运输工具	357,242.00	229,992.80	127,249.20	35.62%
模具	1,103,281.19	836,640.05	266,641.14	24.17%
<b>合计</b>	<b>1,803,804.60</b>	<b>1,338,297.56</b>	<b>465,507.04</b>	<b>25.81%</b>

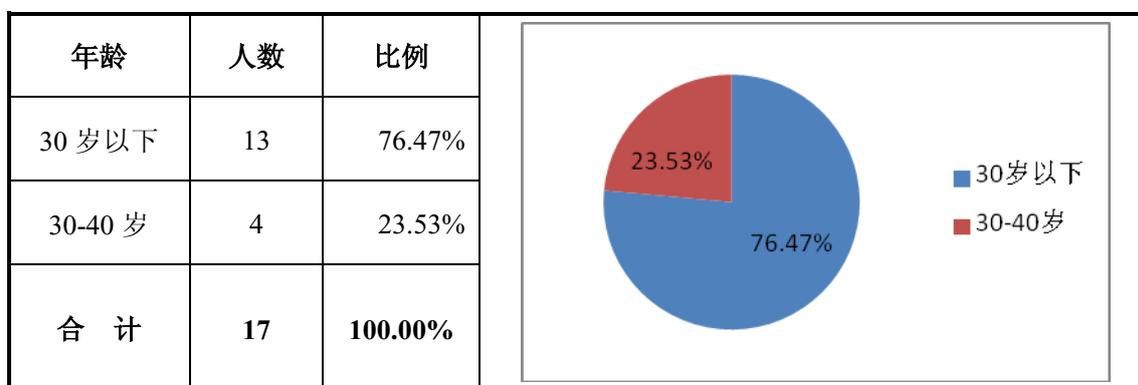
### （六）公司员工情况

截至本说明书出具日，公司共有员工 17 人，结构如下：

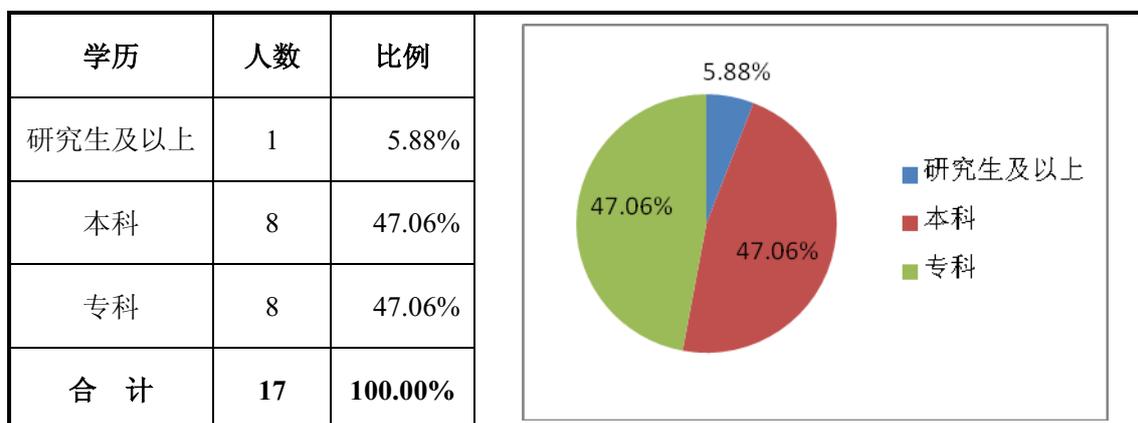
## 1、按工作部门划分



## 2、按年龄结构划分



## 3、按受教育程度划分



## (七) 公司研发情况

## 1、研发机构设置

公司设有独立的研发部门，其职能包括分析、把握行业和市场的发展趋势，集成电路产品设计、工艺设计、新产品开发及老产品改进、组织拟订、完成公司重大技术攻关活动，组织新产品的技术质量鉴定和评审，形成和完善公司技术资

源库等。公司建立了相关管理制度和激励政策，保证了研发的可持续能力。

## 2、研发队伍情况

截至 2014 年 4 月，公司在册员工 17 人，其中研发及技术人员共 12 人，包括公司研发部 9 人及应用部 3 人。公司核心技术人员 2 人。公司研发技术人员均由集成电路设计、微电子、电子信息和物理学等专业毕业的高素质人才组成，占公司总人数的 70.59%。整体而言，公司的研发团队知识结构较为合理，技术精深、专业互补、经验丰富，研发能力较强，有效支撑了公司的研发体系。

研发及技术人员学历结构见下表：

学历	人数	所占比例
研究生及以上	1	8.33%
大学本科	6	50.00%
大专	5	41.67%
合计	12	100.00%

研发及技术人员年龄结构见下表：

年龄	人数	所占比例
21-30 岁	9	75.00%
31-40 岁	3	25.00%
合计	12	100.00%

## 3、核心技术人员

(1) 郑云华，详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

(2) 韩基东详见本说明书第一节“三、公司股权结构及股东情况”之“(二)实际控制人和主要股东情况”。

## 4、研发费用情况

公司重视技术研发，研发投入逐年递增，具有较强的自主研发能力。公司 2012 年研发费用为 1,310,740.98 元，占主营业务收入的 12.52%；2013 年研发费用为 1,564,889.47 元，占主营业务收入的 11.91%。

报告期内公司的研发费用情况如下：

年度	研发费用（元）	主营业务收入（元）	研发费用占主营业务收入的比重
2013年	1,564,889.47	13,143,273.49	11.91%
2012年	1,310,740.98	10,470,677.41	12.52%

#### 四、公司主要产品的产能及销售情况

##### （一）报告期内主要产品销售收入规模

项目	2013年度		2012年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
集成电路芯片销售	13,143,273.49	100%	10,470,677.41	100.00%
合计	13,143,273.49	100%	10,470,677.41	100.00%

##### （二）报告期内公司主要客户情况

2013年，公司前五大客户对公司的收入贡献额为10,442,984.19元，占当年营业收入总额的76.52%，明细如下：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
1	深圳市威步科技有限公司	5,821,791.26	42.66%
2	深圳市和兴健电子有限公司	1,924,161.95	14.10%
3	无锡市菲尔特电子有限公司	1,189,594.95	8.72%
4	深圳芯珑电子技术有限公司	844,424.49	6.19%
5	四川久安芯电子科技有限公司	663,011.54	4.86%
	合计	10,442,984.19	76.52%

2012年，公司前五大客户对公司的收入贡献额为7,765,401.76元，占当年营业收入总额的74.16%，明细如下：

序号	客户名称	销售金额（元）	占营业收入的比例
1	深圳市和兴健电子有限公司	2,829,404.99	27.02%
2	深圳市威步科技有限公司	2,088,793.08	19.95%
3	无锡市菲尔特电子有限公司	1,104,957.26	10.55%
4	无锡友芯集成电路设计有限公司	1,094,853.27	10.46%
5	深圳市金文华音箱制品有限公司	647,393.16	6.18%
	合计	7,765,401.76	74.16%

2012、2013年公司通过经销商销售获得的收入占当年公司销售收入的比例

如下：

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
经销商收入	10,954,808.64	83.35%	9,069,633.25	86.62%
非经销商收入	2,188,464.85	16.65%	1,401,044.16	13.38%
营业收入	13,143,273.49	100.00%	10,470,677.41	100.00%

公司 2012 年、2013 年对前五大客户的销售额占营业收入的比例分别为 74.16%、76.52%，公司客户集中度偏高，主要与公司的行业特性相关。由于集成电路产品应用领域广、客户众多、订单零散，公司主要通过客户资源丰富的经销商进行产品销售。公司 80%以上的销售通过经销商销售实现，这是国内外集成电路设计企业通用的模式。通过经销商进行销售，既可充分利用经销商的销售渠道，又转移了电子制造业市场离散度较高的终端用户应收账款坏账风险。

公司前五大客户中，深圳市威步科技有限公司销售额占比较高，这主要是因为这家公司在该领域的发展时间较长，拥有广阔的终端客户资源，且与终端客户建立了良好的长期合作关系。深圳市威步科技有限公司自公司成立起逐步与公司建立起稳定良好的合作关系，并签订了长期的合作协议，以促进公司在华南地区的业务拓展；而公司产品性价比方面的优越性也为经销商带来了广阔的市场拓展空间，双方创造了一个双赢的市场局面。

公司专注于集成电路的设计研发，尤其是在市场开拓初期，公司需要依靠经销商既有的终端客户资源和强大的拓展能力进行业务拓展，但公司自始至终要求经销商将终端客户详细产品需求、工艺特点等信息向公司进行反馈，使公司能够更全面掌握市场变化并分析了解终端客户需求，并在此基础上更新现有产品和设计、研发新产品。

目前，公司一方面积极加强维护经销商关系，深入与其合作，利用其客户资源拓宽销售网络；另一方面努力拓宽自有的销售渠道，深入开发华东华南地区这一集成电路行业较为发达区域的市场，降低对单个客户的销售占比。公司 2014 年已经拓展了一些新客户并开始建立合作关系，也一定程度上降低了公司对单个客户的销售占比。公司对单一或主要客户不存在重大依赖。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司

5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

### (三) 报告期内公司主要供应商情况

#### 1、主要原材料及供应状况

公司的主要原材料为晶圆，供货充足、市场价格稳定。公司产品所用的晶圆主要向华润上华科技有限公司采购并委托其进行加工。产品封装/测试则主要委托天水华天科技股份有限公司完成。

#### 2、主要原材料、封装/测试费占成本比重

公司属于集成电路行业无生产线设计企业，所有量产产品均采取委托加工方式生产，公司产品的成本主要包括原材料成本和封装测试费用。

公司成本构成情况如下：

项 目	2013 年度	百分比	2012 年度	百分比
原材料	7,919,246.92	70.08%	6,195,607.41	72.79%
封装/测试费	3,381,269.98	29.92%	2,315,547.23	27.21%
合 计	<b>11,300,516.90</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,511,154.64</b>	<b>100.00%</b>

#### 3、公司前五大供应商情况

2012 年，公司对前五大供应商合计采购金额为 9,001,438.59 元，占当年采购总额的 90.08%，明细如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占年度采购总额的比例
1	无锡华润上华科技有限公司	5,463,162.43	54.67%
2	天水华天科技股份有限公司	1,183,663.99	11.85%
3	无锡中微腾芯电子有限公司	908,783.92	9.09%
4	安徽国晶微电子有限公司	868,125.71	8.69%
5	无锡华润上华半导体有限公司	577,702.54	5.78%
	合 计	<b>9,001,438.59</b>	<b>90.08%</b>

2013 年，公司对前五大供应商合计采购金额为 9,757,154.45 元，占当年采购总额的 91.31%，明细如下：

序号	供应商名称	采购金额（元）	占年度采购总额的比例
----	-------	---------	------------

1	天水华天科技股份有限公司	3,508,534.31	32.83%
2	无锡华润上华科技有限公司	3,006,764.99	28.14%
3	无锡中微腾芯电子有限公司	2,124,421.28	19.88%
4	江门市华凯科技有限公司	569,228.71	5.33%
5	无锡华润上华半导体有限公司	548,205.16	5.13%
	<b>合 计</b>	<b>9,757,154.45</b>	<b>91.31%</b>

报告期内，公司对前五大供应商的采购额合计占到当期采购额的 90%左右，这主要是由公司的业务模式决定的。公司采用 Fabless 模式运营，无独立生产线，晶圆生产及封装测试工作均由上游厂商进行，因此对外采购较大且集中度较高。其中华润上华科技主要为公司提供晶圆，天水华天提供芯片封装、测试工作，上述企业均已与公司建立稳定合作关系。

从国内 IC 制造业的总体产业结构来看，由于国内封装测试企业数量较多、市场充分竞争，公司产品在封装和测试企业的技术磨合期较短，公司对这类供应商不存在重大依赖关系；而公司芯片设计与圆片加工企业的工艺参数关联度较高，电路设计须依据工艺参数和工艺线特征，因而达到稳定生产的周期较长，更换代工企业的成本相对较高，对已选定的圆片代工企业有一定的依赖度。降低这一依存度的主要方式为：设计企业须不断提升技术水准，缩短与新工艺线的磨合时间；其次，增加新的备选圆片加工企业。公司在这两方面均已取得进展，已经与华润上华科技之外的圆片加工厂进行合作完成一些产品的设计，并开始试生产。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方、持有公司 5%以上股份的股东均未在上述供应商中占有权益。

#### （四）重大合同及履行情况

报告期内，公司签订的主要房屋租赁合同内容如下：

出租方	承租方	座落位置	面积 (平方米)	单价 (元/月·平方米)	租金	租赁期限
无锡国家集成电路设计基地	无锡汉咏微电子有限公司	无锡新区长江路 21-1 号 无锡国家集成电路设计	38.5	45	20790	2011/04//01-2012/03/31

有 限 公 司		园（创源大厦）207-2			15592.5	2012/04/01/-2012/12/31
					10395	2013/01/01-2013/06/30
					5197.5	2013/07/01-2013/09/30
					5197.5	2013/10/01-2013/12/31
	无 锡 汉 咏 电 子 股 份 有 限 公 司	无 锡 新 区 长 江 路 21 号 信 息 产 业 科 技 园 B 座 405 楼	35	28	11760	2014/01/01-2014/12/31
无 锡 军 转 创 业 园 有 限 公 司	无 锡 汉 咏 电 子 股 份 有 限 公 司 滨 湖 分 公 司	无 锡 市 鸿 桥 路 888 号 618 室	130	30000 元/年		2014/01/01-2014/12/31

2012 年度主要销售合同具体情况如下：

序号	订单日期	客户	订单金额（元）	已执行
1	2012.02	深圳市和兴健电子有限公司	303,020.43	100%
2	2012.05	深圳市和兴健电子有限公司	303,206.39	100%
3	2012.08	深圳市和兴健电子有限公司	495,127.47	100%
4	2012.09	深圳市和兴健电子有限公司	431,132.80	100%
5	2012.10	深圳市和兴健电子有限公司	382,565.46	100%
6	2012.12	深圳市和兴健电子有限公司	393,029.88	100%
7	2012.02	深圳市威步科技有限公司	380,000.00	100%
8	2012.06	深圳市威步科技有限公司	354,258.75	100%
9	2012.09	深圳市威步科技有限公司	949,832.75	100%
10	2012.01	无锡友芯集成电路设计有限公司	417,670.83	100%
11	2012.05	无锡友芯集成电路设计有限公司	414,711.72	100%
12	2012.08	无锡友芯集成电路设计有限公司	448,595.78	100%
13	2012.10	深圳市金文华音箱制品有限公司	314,900.00	100%
14	2012.09	四川久安芯电子科技有限公司	300,000.00	100%
		合 计	<b>5,888,052.26</b>	

2013 年度主要销售合同具体情况如下：

序号	订单日期	客户	订单金额（元）	已执行
1	2013.01	深圳市威步科技有限公司	379,719.00	100%
2	2013.03	深圳市威步科技有限公司	491,364.00	100%
3	2013.04	深圳市威步科技有限公司	550,000.00	100%
4	2013.05	深圳市威步科技有限公司	715,204.25	100%
5	2013.06	深圳市威步科技有限公司	608,924.95	100%
6	2013.07	深圳市威步科技有限公司	695,390.78	100%
7	2013.08	深圳市威步科技有限公司	508,824.39	100%
8	2013.09	深圳市威步科技有限公司	539,193.50	100%
9	2013.10	深圳市威步科技有限公司	891,856.65	100%
10	2013.12	深圳市威步科技有限公司	689,874.20	100%
11	2013.01	深圳市和兴健电子有限公司	1,037,545.16	100%
12	2013.04	深圳市和兴健电子有限公司	653,194.00	100%
13	2013.12	无锡市菲尔特电子有限公司	408,346.86	100%
14	2013.10	深圳芯珑电子技术有限公司	436,232.40	100%
		合 计	<b>8,605,670.14</b>	

## 五、公司商业模式

公司作为集成电路行业无生产线的设计企业，采取“自主研发+委托加工”的商业模式，即将集成电路的晶圆生产、封装测试外包，专注于集成电路设计，符合集成电路垂直分工产业链的特点。同时由于无生产线负担，专注于设计业务，具有灵活性、市场灵敏度高等特点。

公司的关键资源要素在于自主研发并具有自主知识产权的核心技术，以及稳定且经验丰富的研发团队。公司目前主要根据终端产品市场需求，设计各类集成电路芯片产品，并委托代工企业根据公司设计进行加工生产及封装测试，然后经过经销商分销给终端客户获取收益，通过销售收入与代工成本总和之差，实现公司盈利与资金回笼。

公司主要采用通过经销商进行销售的销售模式，这是由集成电路行业特性决定的，IC 产品种类多，分布广泛，客户规模大小不一，通过引入规模较大的经销商有利于增强公司的销售实力以及更好的了解下游市场的需求。

## 六、行业基本情况及公司的竞争地位

### （一）行业概况

## 1、所属行业

公司主要从事集成电路芯片的设计、销售、技术服务、技术转让以及电子产品的开发和销售。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据国民经济行业分类(GB/T 4754-2011)，公司属于C39-计算机、通信和其他电子设备制造业。

## 2、行业监管体制

公司所属的集成电路行业为竞争性行业。行业主管部门为国家发展和改革委员会及国家工业和信息化部。其中，国家发展和改革委员会对行业进行宏观调控和指导；国家工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，针对集成电路行业负责制定行业政策、行业规划，组织制定行业的技术政策、技术体制和技术标准，并对行业的发展方向进行宏观调控。

国家有关行业协会协调指导本行业发展。公司业务相关的行业协会是中国半导体行业协会，该协会是中国集成电路行业的行业自律管理机构。协会下设集成电路分会、半导体分立器件分会、半导体封装分会、集成电路设计分会以及半导体支撑业分会。协会在工信部的指导和管理下，负责产业及市场研究，对会员企业提供行业引导、咨询服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。工信部和中国半导体行业协会构成了集成电路行业的管理体系，各集成电路企业在主管部门的产业宏观调控和行业协会自律规范的约束下，面向市场自主经营，自主承担市场风险。

## 3、行业主要政策法规

公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，具体细分行业为集成电路行业。集成电路作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业，受国家法律法规和多项政策支持。其中主要有：

序号	法律法规及政策名称	时间	相关主要内容
1	《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发18号文）	2000年6月	该政策作为集成电路产业发展的核心政策在税收优惠、生产性原材料进口、集成电路技术和成套生产设备进口、设备折旧、知识产权保护等方面对集成电路产业进行大力扶持。

2	《集成电路布图设计保护条例》	2001年10月	为了保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术的创新，促进科学技术的发展，制定本条例。
3	《集成电路设计企业及产品认定管理办法》（信部联产86号）	2002年3月	为集成电路设计企业享受“国发18号文”制定的审定办法和认定程序。
4	《集成电路产业研究与开发专项资金管理暂行办法》（财建[2005]132号）	2005年4月	明确由国家设立集成电路产业研究与开发专项资金，鼓励集成电路企业加强研究与开发活动。
5	《国家鼓励的集成电路企业认定管理办法》（发改高技[2005]2136）号	2005年10月	规范国家鼓励的集成电路企业认定工作，进一步贯彻落实国务院有关政策及其配套优惠政策。
6	《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007）》年度	2007年1月	明确将集成电路列入当前优先发展的高技术产业（第十三项）。
7	《关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）	2008年3月	明确软件、集成电路行业的企业所得税优惠政策。
8	《电子信息产业调整和振兴规划》	2009年4月	提出了“突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术”的任务目标，并在集成电路产业的产业体系完善、自主创新、产业升级等方面提出优惠措施，加大投入力度及鼓励软件和集成电路产业发展政策的实施力度。
9	《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（国发[2010]32号）	2010年10月	提出了“着力发展集成电路、高端软件、高端服务器等核心基础产业”，集成电路产业作为新一代信息技术产业的重要组成部分，是国家未来重点发展的战略新兴产业。
10	《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）	2011年1月	保持了对《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）的延续，进一步加大对集成电路产业的扶持力度，扩大了扶持范围，优惠政策覆盖了产业链各个环节，产业发展环境将进一步得到优化。
11	《集成电路产业“十二五”发展规划》	2011年12月	作为行业2011-2015年发展的指导性文件，明确了未来发展的指导思想、基本原则和发展目标。
12	《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号	2012年4月	进一步落实国发[2011]4号精神，推动科技创新和产业结构升级，促进信息技术产业发展，明确对软件产业和集成电路产业的企业实施所得税优惠政策。规定

			“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。公司自2010年、2011年享受免税优惠政策,2012至2014年享受减半征收的税收优惠政策。”
13	《关于印发国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定管理试行办法的通知》(发改高技〔2012〕2413号)	2012年8月	文件对国家规划布局内重点软件企业和集成电路设计企业认定的申报条件、申报材料、认定程序、工作要求、罚则等事项重新进行界定和明确。
14	《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录(2011年本)>有关条款的决定》第21号令	2013年2月	将集成电路设计列为鼓励类。

#### 4、进入本行业的主要障碍

##### (1) 技术壁垒

集成电路产品通常作为下游终端产品的嵌入式组件而存在,一方面,追求更低功耗、更高集成度、更小体积依然是技术竞争的焦点;另一方面,产品功能多样化趋势明显,如何不断进行研发投入以生产出能适应各种新产业、新产品的功能需求的芯片产品,持续的技术研发积累对企业发展较为重要,这也成为行业内潜在进入者进入 IC 设计行业的一大主要障碍。

根据集成电路行业著名的摩尔定律,集成电路设计技术每 18 个月就更新换代一次,能否紧跟集成电路设计技术的高速发展、保持持续的核心竞争力和创新能力是进入本行业的另一大技术障碍。芯片新产品上市时的高利润会吸引大量模仿者,造成产品的同质化严重、供过于求,最终导致利润率下降。企业能否在后续竞争中胜出或保持优势,关键是持续地进行技术创新并形成差异化的产品,这就要求企业具有自主核心技术,并具有强大的持续创新能力和产品应用设计能力。

##### (2) 客户关系壁垒

不同公司的集成电路产品通常在嵌入终端产品中需要运用专门的开发工具进行二次开发，当一家终端厂商选择了一个集成电路供应商后，对集成电路的相关指令集及开发工具的熟悉需要一定的时间，这就造成客户有一定的产品黏性。对于集成电路的主要下游应用行业，如电子消费品领域、LED 照明驱动领域，由于对于产品性能稳定性要求较高，所以在选择上游芯片公司时，通常经过一定时间的检测或测试，因此更换芯片供应商亦需要成本投入。较高的客户黏性为后进入者造成了另一大障碍。

### （3）人力资源壁垒

集成电路行业作为典型的技术密集型行业，需要大量的高素质优秀的研发人员，以保证企业的持续研发能力和自主创新能力，同时该行业所面对的市场变化较快，技术不断更新换代。因此，通常一个合格的 IC 设计人才既要熟悉芯片设计制造，又要熟悉芯片下游行业特性及对产品功能的特殊需求等，过硬的专业素质及丰富的产品经验缺一不可。由于目前我国该类高端技术人才相对稀缺，企业之间人才争夺激烈，培养或招募一支高素质的团队对于行业潜在进入者将会构成进入壁垒。

## （二）我国集成电路行业发展现状

### 1、行业发展情况

近几年来，虽然全球半导体产业整体表现疲弱，但国内集成电路产业仍保持了稳定较快增长的势头。根据中国半导体行业协会统计，2013年全国产业销售规模同比增长16.2%，规模为2,508.51亿元。根据国家统计局统计，2013年中国集成电路产量为867.1亿块，同比增长10.4%。根据海关总署统计，2013年中国进口集成电路2,313.4亿美元，同比增长20.4%；2013年中国出口集成电路877亿美元，同比增长64.1%；进出口逆差1,436.4亿美元。

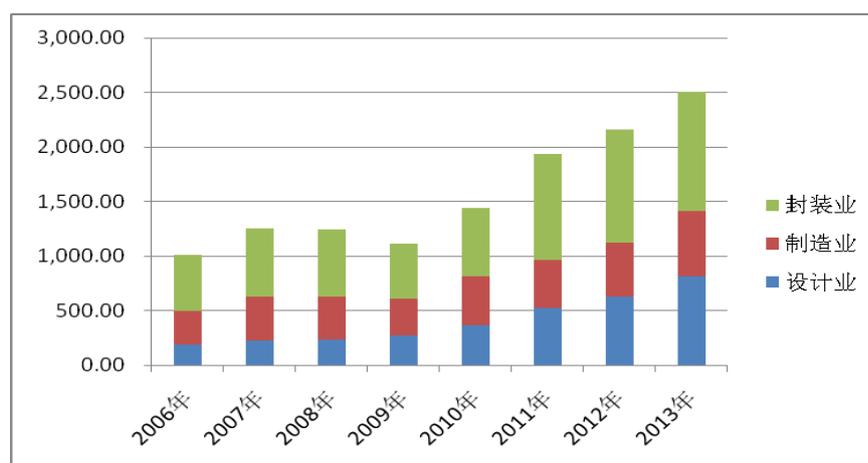
从IC设计、芯片制造以及封装测试三业的发展情况来看，2012年IC设计业销售规模达到808.8亿元，同比增长30.1%；与此同时，在部分新项目产能持续扩大的带动下，芯片制造业与封装测试业保持了平稳增长的势头，其中芯片制造业同比增长19.9%，规模为600.86亿元，封装测试业增长6.1%，规模为1,098.9亿元。

## 我国集成电路设计业、制造业、封测业发展情况

	设计业(亿元)	制造业(亿元)	封测业(亿元)
2006年	186.20	308.50	511.60
2007年	225.70	397.90	627.70
2008年	235.18	392.70	618.91
2009年	269.92	341.10	498.16
2010年	363.85	447.10	629.18
2011年	526.40	431.60	975.70
2012年	621.68	501.10	1,035.67
2013年	808.80	600.86	1,098.85

来源：wind 数据

随着国内集成电路产业的发展，IC设计、晶圆制造和封装测试三业的格局也正不断优化。总体来看，IC设计业与晶圆制造业所占比重呈逐年上升的趋势。2013年，IC设计业所占比重达到32.2%，晶圆制造业比重为24.0%，封装测试业所占比重则已下降至43.8%。



来源：wind数据

## 2、区域产业结构

我国集成电路产业分布整体呈现“一轴一带”分布特征，即东起上海、西至成都的集成电路产业“沿江发展轴”，以及北起大连、南至珠海的集成电路产业“沿海产业带”。长江三角洲地区依靠完善的IC产业链优势，成为IC设计企业最为集中的区域；包括深圳、珠海等城市的珠江三角洲地区，依靠强大的市场需求和销售渠道体系（全国电子元件分销商大约2/3的企业总部在深圳）优势，成为

设计业的又一集中区；而京津环渤海地区则依靠高校和科技单位集中的知识优势，也成为国内IC设计产业的集中区域。

### 3、行业竞争格局

虽然过去十年我国集成电路迅猛发展，但由于起步相对较晚，技术水平整体仍落后于国际先进水平。2013年我国集成电路进出口逆差1,436.4亿美元，这表明很多产品对进口的依赖度依然较高，目前产业的发展速度仍跟不上国内市场的增速，尤其是核心芯片产品及高端芯片产品与国际市场有着较大的技术水平差距。因此欧美、日本等半导体厂商仍占据高端市场的主力位置。台湾厂商和本土厂商在中低端应用市场具有一定价格优势，但由于国内IC设计行业大多规模较小，同质化严重，创新意识不足，尚未能形成强大的研发核心力量与成果或者尚未在细分市场找准自身定位，因此行业内竞争较为激烈。

从产业链结构看，在资本投入密集度较高的集成电路制造和封装测试部分，Intel（美国英特尔）、Samsung（韩国三星）、TI（美国德州仪器）、ST（欧盟意法半导体）和台积电等大型企业已经占据了市场的绝大部分份额，寡头垄断的趋势已经初露端倪。在知识和人才投入更为重要的IC设计业，由于对资本投入的依赖性相对较小，目前还存在着中小IC设计企业的生存空间，竞争对手数量仍相对较多。

### 4、国家政策支持

详见本说明书第二节“六、行业基本情况及公司的竞争地位”之“（一）行业概况”

### （三）行业基本风险

#### 1、市场风险

公司主营业务为集成电路芯片的设计、销售、技术服务、技术转让、电子产品的开发和销售。集成电路产业的波动与全球经济环境密切相关，受全球集成电路产品市场需求和集成电路行业市场波动影响较大。目前国内IC设计企业大多规模较小、同质化严重、创新意识不足，只能凭借价格优势占据中低端产品市场，因而宏观经济波动对本土企业的影响更大。

## 2、行业风险

### (1) 委托加工风险

公司作为集成电路设计企业，采取“自主研发+委外加工”的经营模式。公司仅从事集成电路芯片的设计、销售业务，芯片制造、封装、测试等环节需要依赖外部的供应商生产。

### (2) 技术人才短缺风险

集成电路设计企业，核心竞争力在于企业具有自主研发能力和稳定的研发团队。行业的发展很大程度上取决于产品的研发速度，因此企业对高端技术人才有较大需求。国内集成电路企业对于高端集成电路设计人才的争夺日趋激烈，企业能否保留并吸引更多人才，对于企业未来的发展至关重要，所以行业内技术人才短缺较为明显。

### (四) 公司在行业中的竞争地位

集成电路行业根据所处产业链的不同环节，可划分为集成电路的设计、制造和封装。本公司专注于集成电路芯片的设计与开发。

公司所在的集成电路设计行业参与的公司很多，应用领域广泛，市场比较分散，公司在整个市场中所占市场份额较低。

## 1、竞争对手

公司主要竞争对手的基本情况如下：

### (1) 上海晟矽微电子股份有限公司（430276）

上海晟矽微电子股份有限公司于 2010 年在浦东张江高科技园区成立，是一家专业的集成电路设计和销售企业，具体设计和销售的 IC 产品以微控制器为主，另有少量专用集成电路。公司专注于研发高抗干扰、高可靠性的通用型及专用型 8 位 MCU 产品，用以帮助客户提高系统性能、降低产品开发风险、减少系统总成本以及缩短产品面市时间，并为客户提供相关应用开发工具和整机系统方案。目前公司的主要产品应用从遥控器、锂电、小家电、消费类等领域逐步拓展到智能家居、工业控制、汽车电子等领域。

## (2) 无锡芯朋微电子股份有限公司（430512）

无锡芯朋微电子股份有限公司于 2005 年成立，总部位于江苏省无锡市高新技术开发区内，并在苏州和深圳分别设有研发中心和客户支持服务中心。公司专注于开发绿色电源管理芯片，主要产品包括多种电源管理集成电路和功率晶体管，广泛应用于个人电脑及周边产品、移动电话、个人数字终端、家电产品、平板显示系统等领域。

## (3) 陕西亚成微电子股份有限公司（430552）

陕西亚成微电子股份有限公司于 2003 年成立，主营业务为先进的亚微米 BIPOLAR、CMOS、BICMOS、BCD 等工艺技术的数字模拟混合集成电路产品的设计、开发和销售；公司产品为应用于 LED 照明、网络通信、智能手机、平板电脑及电视机顶盒、计算机及计算机接口设备等多种电子产品的高转换效率、高可靠性、绿色节能电源管理芯片，终端用户遍布全球众多国家和地区。

## 2、公司的竞争优势

相对于同行业的竞争对手，本公司具有如下优势：

### (1) 较强的技术应用和创新能力

公司芯片产品与国内外主要竞争对手的同类产品相比并不逊色，在放大器结构的抗干扰性、工作电压范围、内置振荡器功耗等性能上有显著优势。同时公司的锗隧穿二极管结构具有兼容 CMOS 工艺、便于集成、成本低等优势，与同类产品相比也有一定的竞争力。

### (2) 研发技术优势

目前公司有研发人员 12 名，占员工总数的 70.59%，核心技术人员在集成电路领域从业时间都比较长，积累了扎实的研究及实践经验。根据公司业务发展的需要，公司把急需解决的技术和产品问题作为重点课题列入公司研发计划，由公司提供资金支持，通过自主研发或与高校合作开发新技术和产品，并在实际产品上应用。

### (3) 较稳固的客户关系

公司集成电路芯片产品目前主要应用于车载电子、电脑 USB 外设接口芯片、音频功放及 LED 驱动等领域，公司较为熟悉自己的目标细分市场，并在细分市场上积累了一批客户资源。

### 3、公司的竞争劣势

#### (1) 公司现仍处于初创阶段，自有品牌认知度不高

由于公司成立时间不久，尚处于业务拓展期，下游客户对公司的自有品牌认知度较低，需要有一定的时间扩大品牌知名度及影响力，与更多的经销商建立长期稳定合作关系。

#### (2) 融资渠道限制

公司作为 IC 设计企业，属于典型的轻资产企业，无法通过固定资产抵押等途径获得银行贷款，公司发展受到融资渠道限制。随着融资问题的解决，公司的技术潜力将得到发挥，新产品的开发进度和投放市场的能力将大幅度增强，公司的销售收入的市场占有率以及盈利水平将会得到相应的提高。

### 第三节 公司治理

#### 一、最近二年股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况和相关人员履行职责情况

##### （一）公司股东大会、董事会、监事会建立健全及运行情况

###### 1、有限公司阶段

2010年2月25日，无锡汉咏微电子有限公司取得无锡工商行政管理局新区分局颁发的注册号为320213000127484的《企业法人营业执照》，有限公司成立。自2010年2月25日至2013年12月23日，公司制订了公司章程，并根据公司章程设置了股东会，由于有限公司人数较少，因此并未设立董事会，设执行董事一人，监事一人。公司变更法定代表人、股权转让、增加注册资本、整体改制等事项均履行了股东会决议程序。

###### 2、股份公司阶段

2013年12月23日，有限公司整体变更为股份公司。根据股份公司章程，设立了股东大会、董事会、监事会，并设有总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等管理职位，构建了比较完整的现代企业管理制度。股东大会是公司最高权力机构，负责公司重大事项的决策；董事会是公司经营决策机构，负责公司战略决策的制定；监事会是公司独立的监督机构，对董事会履职情况及管理层的经营管理活动进行监督；总经理领导公司的管理团队，负责公司日常经营活动的执行，对董事会负责。

公司治理结构比较健全，公司基本能够按照各部门、岗位的职责分工进行经营运作。各部门、岗位分工职责较为明确，并有相应的报告和负责对象。公司的经营方针和决策能够自上而下得到较好的执行。公司运作基本规范。股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资融资管理制度》、《投资者关系管理制度》等一系列制度。

2014年2月20日，股份公司召开第一届董事会第二次会议及第一届监事会第二次会议；2014年3月18日，股份公司召开了2013年度股东大会。公司“三会”按照《公司法》及公司章程的规定召开，“三会”会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议通知按时发出，会议决议完整并正常签署。“三会”决议均能得到有效执行。

## （二）公司股东大会、董事会、监事会和有关人员履行职责情况的说明

公司“三会”的人员组成、任职资格均符合《公司法》的要求，基本能够按照“三会”议事规则履行其义务。股份公司成立以来，公司管理层增强了“三会”的规范运作，注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、公司章程和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

除公司股东、董事、监事以外的公司高级管理人员及其他相关人员，也积极行使公司规章制度赋予的权利，履行应尽的义务，目前公司相关工作人员履行职责情况良好。

## 二、公司治理机制执行情况及董事会关于公司治理的自我评估

《公司章程》第三十四条规定公司股东享有以下权利：“（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。”；第一百一十一条规定：“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

《公司章程》第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。”；第一百二十条规定：“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事

出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”

公司股东大会、董事会、监事会审议的事项均属其职权范围内的事项，公司股东、董事、监事也积极行使《公司章程》及“三会”议事规则赋予的权利并履行应尽的义务，公司按照《公司章程》民主选举职工代表监事，目前公司股东大会、董事会、监事会履行职责情况良好。除公司股东、董事、监事以外的公司高级管理人员及其他相关人员，也积极行使《公司章程》和相关公司规章制度赋予的权利并履行应尽的义务，目前公司相关人员履行职责情况良好。

2014 年 4 月，公司董事会出具了《公司董事会关于公司治理机制执行情况的说明和自我评估意见》。公司目前已经建立了适合公司发展规模的内部治理结构，《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等内部控制制度明确规定了机构之间的职责分工和相互制衡、投资者关系管理、财务管理、风险控制等制度。公司董事、监事、高级管理人员符合《公司法》的任职要求，能够按照公司章程及三会议事规则独立、勤勉、诚信地履行职责及义务。公司依公司章程规定定期召开“三会”会议，确保每次会议程序合法，内容有效。公司重大经营活动的决策和执行均按照公司相关治理制度的要求，履行了相关程序，保护了公司及公司股东的正当权益。公司现有治理机制通过制度设计、有效执行，充分保证了合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并依法享有知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。现有公司治理机制符合相关法律法规要求，运行有效且可以满足公司经营发展需求。

### **三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年存在的违法违规及受处罚情况**

公司及其控股股东、实际控制人郑云华、韩基东报告期内不存在违法违规行为，也不存在被相关主管机关处罚的情况。

### **四、公司独立经营情况**

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东独立，且独立于控

股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### （一）业务独立情况

公司的主营业务为集成电路芯片的设计、销售、技术服务、技术转让；电子产品的开发和销售。公司业务涵盖大规模 SoC 数模混合的产品设计，工艺主要以 0.35u、0.18u、0.13u 为主，产品主要包括车载电子视频驱动芯片、电脑 USB 外设接口芯片、音频功放驱动芯片以及 LED 照明驱动芯片。公司根据《企业法人营业执照》所核定的经营范围独立地开展业务。公司具备独立的研发、应用、运营、财务等部门，公司具备完整的业务流程、独立的生产经营场所以及销售渠道。公司经营的业务与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到公司股东及其他关联方的干涉、控制，不存在关联销售和关联采购，不存在影响公司独立性的重大或频繁地关联方交易，也未因与公司股东及其他关联方存在关联关系而使得公司经营的完整性、独立性受到不利影响。同时，为了避免同业竞争的可能性，公司控股股东及持股 5%以上的股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动。

### （二）资产独立情况

股份公司系由无锡汉咏微电子有限公司整体变更设立，原有限公司的资产和负债全部进入公司，主要相关资产和产权的变更登记已经办理。公司业务经营相关的主要资产均由公司拥有相关所有权或使用权；公司目前租赁使用的主要办公用房，均由公司独立地与出租方签订租赁合同。公司对拥有的资产独立登记、建账、核算和管理。公司资产权属清晰、完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业形成重大依赖的情况。

公司最近两年内不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情形。公司为防止股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资源，公司制定了《关联交易决策制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理办法》等。

综上所述，公司目前合法拥有业务经营所必需的经营场所、专利及其他经营

设备的所有权或者使用权，公司目前申请的注册商标已经于 2014 年 2 月 6 日获得国家工商行政管理局商标局初审通过。公司的资产独立完整。

### （三）人员独立情况

公司建立了健全的法人治理结构，公司的董事、监事以及总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的产生，均按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，董事、股东代表监事由股东大会选举产生，总理由董事会聘任，财务总监、副总经理等高级管理人员由总经理提名并经董事会聘任；董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。不存在控股股东超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免决定的情形。公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任职务或领取薪酬。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系，能够自主招聘管理人员和职工，与公司全体员工签订了劳动合同。

### （四）财务独立情况

公司自成立以来设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员。公司实行独立核算，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。公司开立了独立的基本结算账户，未与股东单位及其他任何单位或人士共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税现象。

### （五）机构独立情况

公司依照《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》并设置了相应的组织机构，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的法人治理结构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构、部门依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。公司机构完全独立运作，生产经营场所与控股股东、实际控制人完全分开且独立运作，不存在混合经营、合署办公的情形，拥有完全的机构设置自主权。

## 五、同业竞争情况

### （一）公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业竞争情况

截至本说明书签署日，公司目前的控股股东和实际控制人为郑云华、韩基东，郑云华、韩基东除投资本公司外没有投资其他公司。

### （二）控股股东及实际控制人作出的避免同业竞争的承诺

为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人郑云华、韩基东和持有公司股份 5% 以上的其他主要股东、股份公司的董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“一、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

二、本人在持有股份公司 5% 以上股份期间，本承诺为有效之承诺。

三、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。”

## 六、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执行情况

公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相应规定，对对外担保、对外投资、关联交易等重要事项建立起相应的制度。

### （一）公司对外担保事项的决策和执行情况

最近两年内，公司无对外担保事项。

### （二）公司委托理财事项的决策和执行情况

最近两年内，公司无委托理财事项。

### **(三) 公司重大投资事项的决策和执行情况**

最近两年内，公司不存在重大投资事项。

### **(四) 公司关联交易决策和执行情况**

最近两年内，公司不存在关联交易情形。

### **(五) 为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排**

股份公司成立后，公司制定了相应的公司治理制度，包括公司章程、“三会”议事规则、《关联交易决策制度》等制度，就关联交易审批程序、回避制度、违规处罚等事项作了具体规定。

## **七、公司董事、监事、高级管理人员相关情形的说明**

### **(一) 董事、监事及高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况**

除本说明书第一节“六、公司董事、监事及高级管理人员基本情况”之“(四) 董事、监事及高级管理人员持股情况”所披露的持股情况外，本公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在以任何方式直接或间接持有本公司股份的情形。

### **(二) 董事、监事、高级管理人员之间相互亲属关系**

除公司董事郑云华与叶叶为夫妻关系，其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系。

### **(三) 与公司签订的重要协议或作出的重要承诺**

截至本说明书签署日，公司全体董事、监事、高级管理人员均与公司签署《劳动合同》和《保密协议》。

董事、监事及高级管理人员作出了股份锁定的承诺，具体内容参见本说明书第一节“二、股票挂牌情况”之“(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

### **(四) 董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职情况**

公司董事、监事、高级管理人员中，董事朱星海目前在深圳玖泰电子有限公司担任业务经理，并未在公司实际担任职务。

公司董事、监事、高级管理人员最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分的情形；不存在因涉嫌违法违规行为正处于调查中尚无定论的情形；不存在对现任职和曾任职的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任的情形；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚实行为的情形。

公司董事、监事、高级管理人员不存在对外投资与公司存在利益冲突的情形；公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。

公司全体董事、监事、高级管理人员于 2014 年 4 月出具了《关于诚信等情况的书面声明》，对上述相关事项进行了承诺，并表示截至本承诺出具之日，不存在其他对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

## **八、最近两年董事、监事、高级管理人员变动情况**

最近两年内公司的董事、监事、高级管理人员基本保持稳定，不存在产生重大变动的情形。

## 第四节 公司财务

### 一、公司报告期的审计意见及主要财务报表

公司财务报表反映了 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度、2013 年度的经营成果和现金流量情况。未经特别注明，以下财务数据摘自或者来源于审计报告及会计师出具的相关文件，金额单位均为人民币元。

#### （一）公司报告期的审计意见

公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000129）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日的公司资产负债表和 2012 年度、2013 年度的公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审[2014]8-63 号标准无保留意见的审计报告。

#### （二）公司报告期的主要财务报表

##### 1、公司财务报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

##### 2、公司报告期的资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表

###### （1）公司资产负债表

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,084,422.08	365,134.01

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
交易性金融资产	-	-
应收票据	500,000.00	-
应收账款	2,455,910.29	1,462,247.45
预付款项	101,497.66	37,917.14
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	414,394.50	4,677.75
存货	2,236,557.44	2,755,024.77
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	30,583.79	270,517.59
<b>流动资产合计</b>	<b>9,823,365.76</b>	<b>4,895,518.71</b>
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	465,507.04	662,178.69
在建工程	-	-
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	27,877.36	37,789.48
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	16,157.31	9,620.05
其他非流动资产	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>509,541.71</b>	<b>709,588.22</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,332,907.47</b>	<b>5,605,106.93</b>
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	3,016,716.39	259,826.28
应付账款	1,234,247.28	689,848.48
预收账款	597,500.00	297,366.50
应付职工薪酬	72,540.85	61,288.48
应交税费	6,217.77	9,935.87
应付利息	-	-
应付股利	-	-

项 目	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
其他应付款	122,462.01	300,184.92
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	12,034.00
<b>流动负债合计</b>	<b>5,049,684.30</b>	<b>1,630,484.53</b>
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>5,049,684.30</b>	<b>1,630,484.53</b>
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,000,000.00	4,000,000.00
资本公积	50,557.44	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,266.57	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	209,399.16	-25,377.60
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,283,223.17</b>	<b>3,974,622.40</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>10,332,907.47</b>	<b>5,605,106.93</b>

## (2) 公司利润表

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>13,648,273.49</b>	<b>10,470,677.41</b>
减：营业成本	11,300,516.90	8,511,154.64
营业税金及附加	1,029.15	188.46
销售费用	182,945.47	72,883.60
管理费用	2,585,683.26	1,793,320.69
财务费用	-5,097.47	1,265.13
资产减值损失	74,956.29	13,579.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-491,760.11</b>	<b>78,285.35</b>
加：营业外收入	820,495.00	65,850.00
减：营业外支出	13,657.10	10,471.91

项 目	2013 年度	2012 年度
其中：非流动资产处置损失	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>315,077.79</b>	<b>133,663.44</b>
减：所得税费用	6,477.02	21,220.21
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>308,600.77</b>	<b>112,443.23</b>
<b>五、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.03
<b>六、其他综合收益</b>	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>308,600.77</b>	<b>112,443.23</b>

## (3) 公司现金流量表

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,142,373.29	10,064,403.23
收到的税费返还	-	94,779.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,471,352.17	2,027,212.19
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12,613,725.46</b>	<b>12,186,394.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,804,640.15	8,992,604.62
支付给职工以及为职工支付的现金	718,440.93	442,829.85
支付的各项税费	33,833.09	62,508.27
支付其他与经营活动有关的现金	5,767,142.64	2,750,410.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,324,056.81</b>	<b>12,248,353.39</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>289,668.65</b>	<b>-61,958.60</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,070.69	888,244.63
投资支付的现金	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>308,070.69</b>	<b>888,244.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-308,070.69</b>	<b>-888,244.63</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	500,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	58.33

项 目	2013 年度	2012 年度
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,000,058.33</b>
偿还债务支付的现金	500,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,200.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>519,200.00</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>980,800.00</b>	<b>1,000,058.33</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>962,397.96</b>	<b>49,855.10</b>
加：期初现金及现金等价物余额	105,307.73	55,452.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,067,705.69</b>	<b>105,307.73</b>

## (4) 公司权益变动表

## ①2013 年度公司股东权益变动表

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-25,377.60	3,974,622.40
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	4,000,000.00	-	-	-	-	-25,377.60	3,974,622.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,000,000.00	50,557.44	-	-	23,266.57	234,776.76	1,308,600.77
（一）净利润	-	-	-	-	-	308,600.77	308,600.77
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	308,600.77	308,600.77
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
1.所有者投入资本	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	28,322.31	-28,322.31	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	28,322.31	-28,322.31	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	50,557.44	-	-	-5,055.74	-45,501.7	-

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1.资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	50,557.44	-	-	-5,055.74	-45,501.7	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>50,557.44</b>	-	-	<b>23,266.57</b>	<b>209,399.16</b>	<b>5,283,223.17</b>

## ②2012 年度公司股东权益变动表

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>-137,820.83</b>	<b>2,862,179.17</b>
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>3,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>-137,820.83</b>	<b>2,862,179.17</b>
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>1,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>112,443.23</b>	<b>1,112,443.23</b>
（一）净利润	-	-	-	-	-	112,443.23	112,443.23
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	112,443.23	112,443.23
（三）所有者投入和减少资本	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00

项 目	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
1.所有者投入资本	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备金	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-
（七）其他	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>4,000,000.00</b>	-	-	-	-	<b>-25,377.60</b>	<b>3,974,622.40</b>

## 二、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）财务报表的编制基础

公司财务报表以持续经营为编制基础。

### （二）遵循企业会计准则的声明

财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### （三）会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本说明书所载财务信息的会计期间为 2012 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止。

### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### （五）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起 3 个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

### （六）应收款项

#### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额 100 万元以上且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值差额计提坏账准备。

#### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

##### （1）确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

## (2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,以下同)	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3年以上	100.00	100.00

## (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## (七) 存货

### 1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在加工过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的原材料和物料等。

### 2、发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,

分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (八) 固定资产

#### 1、固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

#### 2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	10	5	9.50
通用设备	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	5	5	19.00
模具	工作量法(注)		

注：模具采用的折旧方法系工作量法中的产量法。

#### 3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (九) 借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。报告期公司没有符合资本化条件的借款费用，因此公司借款费用全部计入当期财务费用。

### (十) 无形资产

#### 1、无形资产包括软件，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体期限如下：

项 目	摊销期限
软件	5 年

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4、内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## （十一）收入

### 1、销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司的销售采用直销和分销相结合的模式，即公司直接销售给终端客户和销

售给经销商，经销商再销售给终端客户。公司以开出发票的时点作为确认收入的时点。

## 2、提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 3、让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## （十二）政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。

2、对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计

量。

4、与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### **（十三）递延所得税资产、递延所得税负债**

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### **（十四）经营租赁**

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### **（十五）主要会计政策、会计估计的变更及对公司利润的影响**

本报告期内，公司不存在会计政策、会计估计的变更。

### 三、公司报告期主要会计数据和财务指标

公司报告期主要会计数据及财务指标简表：

项目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	1,033.29	560.51
股东权益合计（万元）	528.32	397.46
归属于申请挂牌公司股东的权益合计（万元）	528.32	397.46
每股净资产（元/股）	1.06	0.99
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.06	0.99
资产负债率（%）	48.87	29.09
流动比率（倍）	1.95	3.00
速动比率（倍）	1.50	1.15
项目	2013年度	2012年度
营业收入（万元）	1,364.83	1,047.07
净利润（万元）	30.86	11.24
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	30.86	11.24
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-49.89	5.48
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-49.89	5.48
毛利率（%）	17.20	18.71
净资产收益率（%）	7.18	3.37
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-11.61	1.64
基本每股收益（元/股）	0.07	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.03
应收账款周转率（次）	6.97	7.72
存货周转率（次）	4.53	3.87
经营活动产生的现金流量净额（万元）	28.97	-6.20
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	-0.02

#### （一）盈利能力分析

报告期内营业收入随着销售规模的扩大稳定增长。2013年公司毛利率为17.20%，2012年为18.71%，毛利率有所下降，主要是因为公司主营业务毛利率的下降导致。2013年度、2012年度公司主营业务毛利率分别为14.02%、18.71%，呈下降趋势，主要原因一是为了应对集成电路芯片行业的市场竞争，公司2013年度主要产品车载电子芯片HY005、HYT001和电脑USB外设芯片HY001的单位售价较2012年度降低，导致上述三类产品毛利率降低；二是2013年度公司音

频功放芯片中高毛利率产品 HY004 面临市场上同类产品的激烈竞争，销量较 2012 年度大幅减少；三是 2013 年度，公司为占领市场采取低价策略推广新产品音频功放芯片 HY021、HYE003 和电脑 USB 外设芯片 HY029，使得该三类产品的毛利率较低。报告期内，2013 年公司获得的政府补贴金额较大，使得公司 2013 年利润水平得到较大提升。营业收入、营业利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润及毛利率变动详见本节“（四）报告期利润形成的有关情况”。

公司 2012 年度、2013 年度的净资产收益率分别为 3.37%、7.18%，公司报告期内净资产收益率呈上升趋势，主要因为 2013 年度公司获得的政府补贴金额较大，使得公司 2013 年利润水平得到较大提升。2012 年度、2013 年度扣除非经常性损益后的净资产收益率分别为 1.64%、-11.61%，公司 2013 年度的基本每股收益为 0.07 元，2012 年度为 0.03 元。

## （二）偿债能力分析

2012 年 12 月 31 日和 2013 年 12 月 31 日公司的资产负债率分别为 29.09%、48.87%，流动比率分别为 3.00 倍、1.95 倍。公司流动比率下降主要是由于两方面的原因造成的，一方面公司 2013 年采用银行承兑汇票进行付款致使应付票据和其他货币资金大幅度增加，而流动负债的增加幅度大大超过流动资产的增加幅度；另一方面随着公司业务规模的扩大，公司营运负债也随之增加。速动比率分别为 1.15 倍、1.50 倍，速动比率增高系 2013 年末存货库存余额较 2012 年末减少所致。公司资产结构合理，流动资产变现较强，偿债风险较小。

## （三）营运能力分析

公司 2012 年度、2013 年度应收账款周转率分别为 7.72 次/年、6.97 次/年，报告期内公司应收账款周转率比较稳定，回款情况良好。存货周转率分别为 3.87 次/年、4.53 次/年，报告期内公司存货周转率有所增长，主要是 2013 年末存货中原材料的金额下降导致公司存货周转率有所上升。

## （四）现金流量分析

报告期内，公司 2012 年度经营活动产生的现金流量净额为负数，2013 年度经营活动产生的现金流量为 28.97 万元，主要是由于随着业务规模的扩大公司

2013 年度销售收入增加，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加较多。

#### 四、报告期利润形成的有关情况

##### (一) 营业收入的主要构成、变动趋势及原因

##### 1、营业收入的主要构成、变动趋势及原因

报告期内公司营业收入的构成情况如下：

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
主营业务收入	13,143,273.49	96.30%	10,470,677.41	100.00%
其他业务收入	505,000.00	3.70%	-	-
<b>营业收入</b>	<b>13,648,273.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,470,677.41</b>	<b>100.00%</b>

公司 2013 年度主营业务收入占营业收入的比例为 96.30%，2012 年度主营业务收入占营业收入的比例为 100%，主营业务突出。2013 年度其他业务收入为 50.50 万元，系公司技术转让收入。

2013 年度营业收入相比 2012 年度增长了约 317.76 万元，增长比率 30.35%。主要是近年来随着我国集成电路芯片设计行业飞速发展，公司报告期内主营业务收入呈增长趋势，2013 年度集成电路芯片销售收入相比 2012 年增长了约 267.26 万元，同时 2013 年度公司还获得技术转让收入共计 50.50 万元。

##### 2、主营业务收入的主要构成、变动趋势及原因

主营业务收入构成情况如下：

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比
集成电路芯片销售	13,143,273.49	100.00%	10,470,677.41	100.00%
<b>合计</b>	<b>13,143,273.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,470,677.41</b>	<b>100.00%</b>

公司主营业务收入均来源于集成电路芯片销售收入。

按照产品类别分类具体分类如下：

项目	2013 年度		2012 年度	
	金额（元）	占比	金额（元）	占比

集成电路芯片销售				
车载电子视频驱动芯片	2,092,233.38	15.92%	1,947,014.67	18.59%
电脑 USB 外设接口芯片	5,357,047.54	40.76%	3,451,166.93	32.96%
音频功放驱动芯片	3,523,994.45	26.81%	4,040,700.81	38.59%
LED 照明驱动芯片	1,049,348.98	7.98%	734,399.15	7.01%
其他领域	1,120,649.07	8.53%	297,395.80	2.84%
<b>合计</b>	<b>13,143,273.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,470,677.41</b>	<b>100.00%</b>

公司近两年主营业务收入按地区分类如下表：

地区	2013 年度		2012 年度	
	收入（元）	占比	收入（元）	占比
华 南	10,108,022.21	76.91%	6,242,402.04	59.62%
华 东	2,286,769.59	17.40%	3,424,368.92	32.70%
其 他	748,481.69	5.69%	803,906.45	7.68%
<b>合 计</b>	<b>13,143,273.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>10,470,677.41</b>	<b>100.00%</b>

公司的收入来源有比较明显的地域特征，主要来自于华南、华东地区，也有少部分收入来源于北京、四川等其他地区。2012 年华南及华东地区收入占主营业务收入的 92.32%，2013 年则为 94.31%，主要是因为国内集成电路产业集中分布在长江三角洲和珠江三角洲两大区域。长江三角洲地区依靠完善的 IC 产业链优势，成为 IC 企业最为集中的区域。深圳、珠海等城市的珠江三角洲地区，依靠强大的市场需求和销售渠道体系（全国电子元件分销商大约 2/3 的企业总部在深圳）优势，成为 IC 产业的又一集中区。由此可见，公司收入来源的地域性特征符合行业规律。

### 3、产品毛利率变动及原因

公司主营业务收入中，各项系列产品的毛利率情况如下表：

项 目	2013 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
集成电路芯片销售	13,143,273.49	11,300,516.90	14.02%
<b>合计</b>	<b>13,143,273.49</b>	<b>11,300,516.90</b>	<b>14.02%</b>
项 目	2012 年度		
	收入（元）	成本（元）	毛利率
集成电路芯片销售	10,470,677.41	8,511,154.64	18.71%
<b>合计</b>	<b>10,470,677.41</b>	<b>8,511,154.64</b>	<b>18.71%</b>

在同行业公司中，新三板挂牌公司亚成微（430552）同样从事集成电路芯片

设计业务，其细分业务与公司业务相似，因此以亚成微作为样本公司与公司主要财务数据比较并分析。同行业样本公司亚成微对比期间财务数据如下：

项目	2013 年	2012 年
毛利率 (%)	28.86	25.74

公司报告期内毛利率及集成电路芯片毛利率与同行业样本公司亚成微的集成电路芯片毛利率相比，两者差异较大，主要是因为公司与同行业样本公司的产品定位不同。

样本公司亚成微成立时间较长，经过多年的成长，产品定位与本公司相比有所差异，主要定位于先进工艺技术的数字模拟混合集成电路产品，并凭借其先进的工艺技术和产品高性能的特点获得较高的毛利率。

公司于 2010 年成立，目前仍处于成立初期，对新产品的研发相对保守，公司的产品主要定位于车载电子视频驱动芯片、电脑 USB 外设接口芯片、音频功放驱动芯片以及 LED 照明驱动芯片中成熟的通用型产品，由于定位不同，公司与样本公司相比毛利率较低。由于音频功放驱动芯片系列的相关产品的进入门槛低、研发周期短且研发投入小，因此 2013 年度公司为尽快取得研发成效而选择研发毛利率水平较低的几种音频功放驱动芯片，与此同时公司为进行市场推广对其实行较低的定价策略，也使得公司的利润水平较低。综上所述，公司产品销售的毛利率与同行业样本公司相比偏低。

2013 年度、2012 年度公司主营业务毛利率分别为 14.02%、18.71%，呈下降趋势。主要原因一是为应对集成电路芯片行业激烈的市场竞争，公司 2013 年度主要产品车载电子芯片 HY005、HYT001 和电脑 USB 外设芯片 HY001 由于技术成熟、市场同质化产品竞争激烈而降低了销售价格，导致上述三类产品毛利率降低，分别从 2012 年度的 29.53%、16.71%和 21.76%降低到 2013 年度的 23.94%、13.97 和 16.72%，同时 2013 年该三种产品由于价格降低而吸引客户致使销量大幅度上涨；二是 2012 年度公司新开发的音频功放芯片中芯片 HY004 的毛利率较高，销量也较好，到 2013 年度市场上同类产品的激烈竞争，该产品逐步被市场同质化产品取代从而销量大幅度下降；三是 2013 年度，由于音频功放驱动芯片系列的相关产品的进入门槛低、研发周期短且研发投入小，因此为尽快取得研发成效公司选择研发毛利率水平较低的新产品，主要包括音频功放芯片 HY021、

HYE003 和电脑 USB 外设芯片 HY029，新产品进入市场初期主要采用价格上的优惠来吸引客户以拓宽新产品的销售渠道，与合作的经销商保持良好的客户关系，从而在未来新产品的销售方面打好基础，因此该三种产品的毛利率均比较低，2013 年的销售量合计为 275.81 万元。综上所述，公司 2013 年度毛利率较 2012 年度会有所下降。

集成电路行业新产品上市时的高利润会吸引大量模仿者，造成产品的同质化严重、供过于求，最终导致利润率下降。鉴于此，集成电路行业设计技术更新换代较为迅速。因此，紧跟集成电路设计技术的高速发展、保持持续的研发和创新能力是集成电路行业设计企业保持核心竞争力的关键。公司能否在后续竞争中胜出或保持优势，主要是持续地进行技术创新并形成差异化的产品，并具有强大的持续创新能力和产品应用设计能力。

目前公司主要研发的产品有：①面向汽车电子应用的 CAN 总线主控芯片；②面向平板电脑应用的 USB 转以太网接口转换芯片；③公司借助无锡的国家传感网中心的优势在拓展物联网芯片领域和江南大学联合承担了“面向传感网应用的 2.4GHz Zigbee SoC 芯片”无锡物联网发展专项项目。

总体而言，公司具有较强的自主研发能力，未来将进一步加强加快新产品的研发进程，公司还将加强对市场变化的感知，调自身整产品结构，逐步减少市场已饱和的同质化产品，加快步伐开发高毛利率的新产品或对现有产品的品质进行改良，从而拓展新的业务领域，吸引和留住新老客户，以期未来能够占领目标市场。

## （二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因

公司报告期内营业收入和利润总额及变动情况如下：

项 目	2013 年度（元）	2012 年度（元）	2013 较 2012 增长率
营业收入	13,648,273.49	10,470,677.41	30.35%
营业成本	11,300,516.90	8,511,154.64	32.77%
毛利	2,347,756.59	1,959,522.77	19.81%
期间费用汇总	2,763,531.26	1,867,469.42	47.98%
营业利润	-491,760.11	78,285.35	-728.16%
利润总额	315,077.79	133,663.44	135.72%
净利润	308,600.77	112,443.23	174.45%

2012 年度、2013 年度公司的营业收入分别为 10,470,677.41 元、13,648,273.49 元。公司 2013 年度营业收入比 2012 年度增加 3,177,596.08 元，增幅 30.35%。其中，2013 年技术转让收入为 505,000.00 元，2013 年度集成电路芯片销售收入比 2012 年度增加 2,672,596.08 元，增幅为 25.52%。营业收入的上涨主要是因为公司 2013 年度推出的新产品，营业收入随着业务规模的扩大而大幅增长。

2012 年度、2013 年度公司的营业成本分别为 8,511,154.64 元、11,300,516.90 元。公司营业成本主要为原材料和封装测试费。公司 2013 年度营业成本比 2012 年度增加 2,789,362.26 元，增幅 32.77%。营业成本随着营业收入的增长而增加，由于新产品推广定价较低，新产品的毛利率也相对较低，因此营业成本的增长幅度比营业收入的增长幅度大。

2012 年度、2013 年度公司的期间费用分别为 1,867,469.42 元、2,763,531.26 元。2013 年度期间费用相对 2012 年度增加 896,061.84 元，增幅 47.98%，主要是随着公司业务规模的扩大，2013 年度公司的研发费用增多且公司提高了职工薪酬水平，此外公司 2013 年中介机构咨询顾问费有所增长。

2012 年度、2013 年度公司营业利润分别为 78,285.35 元、-491,760.11 元，2013 年度公司营业利润比 2012 年度下降较多，主要原因一是公司新品推广定价较低导致毛利降低，二是期间费用有较多增长。2012 年度、2013 年度公司净利润分别为 112,443.23 元、308,600.77 元，2013 年度公司净利润比 2012 年度有所上涨，原因是 2013 年度公司获得的政府补助较多所致。具体参见本节“四、非经常性损益情况”。

### （三）主要费用及变动情况

公司报告期主要费用及变动情况如下：

项 目	2013 年度 金额（元）/占比	2012 年度 金额（元）/占比	2013 年度比 2012 年度的增长率
营业收入	13,648,273.49	10,470,677.41	30.35%
销售费用	182,945.47	72,883.60	151.01%
管理费用	2,585,683.26	1,793,320.69	44.18%
其中：研发费用	1,564,889.47	1,310,740.98	19.39%
财务费用	-5,097.47	1,265.13	-502.92%
期间费用合计	2,763,531.26	1,867,469.42	47.98%

销售费用/营业收入	1.34%	0.70%	92.57%
管理费用/营业收入	18.95%	17.13%	10.62%
其中：研发费用	11.47%	12.52%	-8.39%
财务费用/营业收入	-0.04%	0.01%	-409.11%
<b>期间费用/营业收入</b>	<b>20.25%</b>	<b>17.84%</b>	<b>13.53%</b>

2013 年度公司销售费用主要包括广告费与业务宣传费、网络服务费以及销售人员的工资、差旅费、交通费、业务招待费等，与 2012 年度相比销售费用增加 11.01 万元，主要原因为公司的广告宣传费、网络服务费等增多。

2013 年度公司管理费用主要包括研究开发费、咨询顾问费、折旧费、职工薪酬、办公费用等。与 2012 年度相比管理费用增加 79.24 万元，主要是随着公司业务规模的增长公司的研发费用、职工薪金也分别增加了 25.41 万元、11.03 万元，同时 2013 年公司股改时进行资产评估、财务报表审计以及财务顾问等从而支付给中介机构咨询顾问费共 25.00 万元。

2012 年度及 2013 年度，公司财务费用主要为利息支出、利息收入及银行手续费等。2013 年度公司的利息支出主要为短期银行借款利息支出，利息收入主要为大额承兑汇票的保证金存款利息收入。

#### （四）非经常性损益情况

1、公司非经常性损益的构成情况如下：

类 别	2013 年度（元）	2012 年度（元）
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	807,875.00	65,850.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,611.19	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
<b>小计</b>	<b>820,486.19</b>	<b>65,850.00</b>
减：所得税费用（所得税费用减少以“-”表示）	102,560.77	8,231.25
扣税限额（以当期所得税费用为限）	13,014.28	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>807,471.91</b>	<b>57,618.75</b>
<b>当期净利润</b>	<b>308,600.77</b>	<b>112,443.23</b>
<b>非经常性损益净额占净利润的比例</b>	<b>261.66%</b>	<b>51.24%</b>

公司的大额非经常性损益主要来自政府财政补贴。报告期内公司非经常性损

益的变化主要系公司取得的政府补助变化所致。公司 2012 年度和 2013 年度非经常性损益占利润总额比例分别为 51.24%和 261.66%，非经常性损益对公司的净利润影响较高。

## 2、报告期内公司获得政府补助明细如下：

### (1) 2013 年度

项 目	金额（元）	说明
无锡市物联网发展专项资金	263,000.00	无锡市经济和信息化委员会、无锡市财政局联合颁发的《关于下达 2013 年度无锡市物联网发展专项资金（第一批）的通知》（锡经信综合[2013]7 号、锡财工贸[2013]91 号）的相关规定，公司获得无锡市物联网发展专项基金人民币 26.3 万元。
集成电路专项补贴	539,100.00	根据《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会关于推动科技创新创业的实施意见》（锡高管发[2011]7 号）的规定，经公司向有关部门提出申请，分别获得无锡市人民政府新区管理委员会财政局于 2013 年 2 月 19 日发放的财政补贴 337,700.00 元、2013 年 12 月 7 日发放的财政补贴 201,400.00 元 共计 539,100.00 元。
房租补贴	5,775.00	根据《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会关于推动科技创新创业的实施意见》（锡高管发[2011]7 号）的规定，经公司向有关部门提出申请，公司获得无锡市人民政府新区管理委员会财政局于 2013 年 9 月 10 日发放的房租补贴 5,775 元。
<b>合 计</b>	<b>807,875.00</b>	

### (2) 2012 年度

项 目	金额（元）	说明
集成电路专项补贴	54,300.00	根据《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会关于推动科技创新创业的实施意见》（锡高管发[2011]7 号）的规定，经公司向有关部门提出申请，分别获得无锡市人民政府新区管理委员会财政局于 2012 年 1 月 18 日发放的财政补贴 38,300.00 元、2012 年 12 月 28 日发放的孵化器财政补贴 16,000.00 元，共计 54,300.00 元。

房租补贴	11,550.00	根据《无锡国家高新技术产业开发区管理委员会关于推动科技创新创业的实施意见》(锡高管发[2011]7号)的规定,经公司向有关部门提出申请,公司分别获得无锡市人民政府新区管理委员会财政局于2012年5月31日和2012年12月28日各发放的房租补贴5,775元。
<b>合计</b>	<b>65,850.00</b>	

## (五) 主要税项及享受的税收优惠政策

### 1、主要税项

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
防洪保安基金	营业收入	0.10%
企业所得税	应纳税所得额	12.50%

根据《江苏省防洪保安资金征收和使用管理规定》，企业缴纳的防洪保安资金，在“营业外支出”科目下增设“防洪保安资金”明细科目列支。

### 2、税收优惠政策

根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的相关规定，我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。

公司2010年、2011年享受免税优惠政策，2012至2014年享受减半征收的税收优惠政策，即2012年、2013年企业按照12.5%的所得税率缴纳企业所得税。

根据企业所得税法第三十条规定，开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。根据《关于研究开发费用税前加计扣除有关政策问题的通知》(财税[2013]70号)和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》(国家发展改革委等部门2011年度第11

号公告)规定,无锡高新区国税局认定公司相关研究开发项目符合上述规定,予以登记并享受研发费用加计扣除的税收优惠。

## 五、公司报告期主要资产情况

### (一) 货币资金

项 目	2013 年 12 月 31 日 (元)	2012 年 12 月 31 日 (元)
银行存款	1,067,705.69	105,307.73
其他货币资金	3,016,716.39	259,826.28
<b>货币资金总额</b>	<b>4,084,422.08</b>	<b>365,134.01</b>

2012 年末、2013 年末公司其他货币资金分别为 259,826.28 元和 3,016,716.39 元,均为应付票据保证金。

### (二) 应收账款

#### 1、应收账款总额及坏账准备情况

项 目	2013 年 12 月 31 日 (元)	2012 年 12 月 31 日 (元)
应收账款余额	2,585,168.73	1,539,207.85
坏账准备	129,258.44	76,960.39
<b>应收账款净额</b>	<b>2,455,910.29</b>	<b>1,462,247.46</b>

公司 2012 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 1,462,247.46 元及 2,455,910.29 元。2012 年末账面价值占资产总额的 26.09%、2013 年末账面价值占资产总额的 23.77%。

#### 2、应收账款账龄结构及坏账准备情况

(1) 2013 年 12 月 31 日,应收账款按账龄结构列示如下:

账 龄	账面余额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
1 年以内	2,585,168.73	100.00	129,258.44
<b>合 计</b>	<b>2,585,168.73</b>	<b>100.00</b>	<b>129,258.44</b>

(2) 2012 年 12 月 31 日,应收账款按账龄结构列示如下:

账 龄	账面余额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
1 年以内	1,539,207.85	100.00	76,960.39
<b>合 计</b>	<b>1,539,207.85</b>	<b>100.00</b>	<b>76,960.39</b>

报告期内，公司应收账款主要来自于集成电路芯片销售收入。

公司 2012 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日的应收账款净额分别为 1,462,247.46 元及 2,455,910.29 元，应收账款 2013 年末比 2012 年末上升 99.37 万元，增长比例 67.95%，主要为公司 2013 年销售收入相对 2012 年有较高增长，但应收账款回款相对放缓所致。2012 年公司对所有经销商均采用月结 30 天的账期，2013 年公司对长期合作且业务量较大的经销商给予月结 60 天的账期。由于 2013 年末新增的应收账款较多且尚未回款，截至报告期末应收账款期末余额有所增加。

公司应收账款报告期内应收账款账龄均在一年以内，与客户结算货款周期较短，期后收回情况良好。

3、截至 2013 年 12 月 31 日，应收账款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项，无应收关联方账款情况。

#### 4、报告期内应收账款金额前五名单位情况

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与公司关系	应收账款期末余额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
深圳市威步科技有限公司	无关联关系	1,349,532.37	1 年以内	52.20%
深圳市和兴健电子有限公司	无关联关系	424,916.45	1 年以内	16.44%
无锡市菲尔特电子有限公司	无关联关系	408,346.86	1 年以内	15.79%
深圳芯珑电子技术有限公司	无关联关系	296,976.65	1 年以内	11.49%
无锡思扬微电子科技有限公司	无关联关系	76,000.00	1 年以内	2.94%
<b>合计</b>		<b>2,555,772.33</b>		<b>98.86%</b>

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与公司关系	应收账款期末余额（元）	账龄	占应收账款总额的比例
深圳市和兴健电子有限公司	无关联关系	587,452.75	1 年以内	38.17%
深圳市威步科技有限公司	无关联关系	289,095.15	1 年以内	18.78%
无锡瑞诺微电子有限公司	无关联关系	206,458.81	1 年以内	13.41%
北京富华万通科技有限公司	无关联关系	190,000.00	1 年以内	12.35%
深圳市金文华音箱制品有限公司	无关联关系	187,500.00	1 年以内	12.18%
<b>合计</b>		<b>1,460,506.71</b>		<b>94.89%</b>

2013年12月31日，应收账款金额前五名欠款单位的欠款金额合计为2,555,772.33元，占应收账款总额的比例为98.86%；2012年12月31日，应收账款金额前五名欠款单位的欠款金额合计为1,460,506.71元，占应收账款总额的比例为94.89%。

### （三）应收票据

2012年12月31日及2013年12月31日应收票据具体情况如下：

种类	2013年12月31日(元)	2012年12月31日(元)
银行承兑汇票	500,000.00	-
合计	<b>500,000.00</b>	-

截至2013年12月31日，应收票据余额为500,000.00元，为银行承兑汇票，2014年1月3日已到期承兑。具体明细如下：

出票者名称	出票日	币种	票面金额	到期日
成都建国汽车贸易有限公司	2013年7月3日	人民币	500,000.00	2014年1月3日

截至2013年12月31日，公司无已质押的应收票据情况；无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；无已经背书给他方但尚未到期的票据。

### （四）预付账款

#### 1、预付账款按账龄列示

报告期内，预付账款按账龄结构列示如下：

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额(元)	比例(%)	账面余额(元)	比例(%)
1年以内	101,497.66	100.00	37,917.14	100.00
合计	<b>101,497.66</b>	<b>100.00</b>	<b>37,917.14</b>	<b>100.00</b>

公司预付账款主要为支付给供应商的原材料采购款。2013年12月31日及2012年12月31日的预付账款分别为101,497.66元及37,917.14元。预付账款金额较小，占总资产规模比例较低。

2、截至2013年12月31日，预付账款中无预付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项，无预付关联方账款情况。

### 3、报告期内主要预付款项金额单位情况

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日主要预付款项单位情况：

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额（元）	账龄	占预付账款总额的比例	性质
无锡华润上华科技有限公司	非关联方	85,297.66	1 年以内	84.04%	货款
深圳市微芯集成电路设计有限公司	非关联方	16,200.00	1 年以内	15.96%	货款
<b>合计</b>		<b>101,497.66</b>		<b>100.00%</b>	

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日主要预付款项单位情况：

单位名称	与本公司关系	预付账款期末余额（元）	账龄	占预付账款总额的比例	性质
无锡华润晶芯半导体有限公司	非关联方	26,640.00	1 年以内	70.26%	货款
无锡华润微电子有 限公司	非关联方	11,100.00	1 年以内	29.27%	货款
无锡华润华晶微电子有 限公司	非关联方	177.14	1 年以内	0.47%	货款
<b>合计</b>		<b>37,917.14</b>		<b>100.00%</b>	

报告内公司预付账款金额较小，账期均在一年以内。

### (五) 其他应收款

1、其他应收款总额及坏账准备情况：

项目	2013 年 12 月 31 日（元）	2012 年 12 月 31 日（元）
其他应收款余额	437,572.50	5,197.50
坏账准备	23,178.00	519.75
<b>其他应收款净额</b>	<b>414,394.50</b>	<b>4,677.75</b>

公司其他应收款主要为房屋押金、员工备用金及应收其他公司款项等，均采用组合测试（账龄分析）法计提坏账准备。2012 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日的其他应收款余额分别为 5,197.50 元及 437,572.50 元。

2013 年末其他应收款较 2012 年末余额增加，主要由于公司出借无锡瑞诺微电子有限公司 400,000.00 元所致。

2、按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

(1) 2013 年 12 月 31 日，其他应收款按账龄结构列示如下：

账龄	2013 年 12 月 31 日		
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
1 年以内	432,375.00	98.81	21,618.75
1-2 年	-	-	-
2-3 年	5,197.50	1.19	1,559.25
合 计	<b>437,572.50</b>	<b>100.00</b>	<b>23,178.00</b>

(2) 2012 年 12 月 31 日，其他应收款按账龄结构列示如下：

账龄	2012 年 12 月 31 日		
	金额 (元)	比例 (%)	坏账准备 (元)
1 年以内	-	-	-
1-2 年	5,197.50	100.00	519.75
合 计	<b>5,197.50</b>	<b>100.00</b>	<b>519.75</b>

2012 年 12 月 31 日及 2013 年 12 月 31 日公司超过 1 年账龄的其他应收款系公司租房押金。

### 3、报告期内其他应收款中主要债务人

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日其他应收款前五名情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额 (元)	账龄	占比 (%)	性质
无锡瑞诺微电子有限公司	非关联方	400,000.00	1 年以内	91.41%	往来款
吴彩虹	公司员工	30,000.00	1 年以内	6.86%	备用金
无锡国家集成电路设计基地有限公司	非关联方	5,197.50	2-3 年	1.19%	租房押金
中华人民共和国国家知识产权局专利局	非关联方	2,005.00	1 年以内	0.46%	服务费
无锡航天信息有限公司	非关联方	370.00	1 年以内	0.08%	服务费
合 计		<b>437,572.50</b>		<b>100.00%</b>	

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日主要其他应收款情况：

单位名称	与本公司关系	账面余额 (元)	账龄	占比 (%)	性质
无锡国家集成电路设计基地有限公司	非关联方	5,197.50	1-2 年	100.00	租房押金
合 计		<b>5,197.50</b>		<b>100.00</b>	

截至 2013 年 12 月 31 日，公司大额其他应收款主要为其他应收无锡瑞诺微电子有限公司 40 万元。公司于 2013 年 10 月 14 日和 10 月 18 日分别借给无锡瑞诺微电子有限公司 200,000.00 元，双方未签订借款协议，没有约定利息，截至 2013 年 12 月 31 日，该借款尚未归还。2014 年 3 月 27 日，无锡瑞诺微电子有限公司归还全部借款共 400,000.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应收款欠款金额前五名占其他应收款总额比例 100%。

截至 2014 年 3 月 27 日，公司已将资金拆借全部清理完毕。公司全体股东作出承诺，在今后的经营过程中，不通过资金拆借等违规方式向其他企业借出款项。

4、截至 2013 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

## （六）存货

公司报告期的存货情况如下：

项 目	2013 年 12 月 31 日（元）	2012 年 12 月 31 日（元）
原材料	163,179.48	1,055,587.38
半成品	454,349.54	230,543.05
库存商品	1,619,028.42	1,468,894.34
合 计	<b>2,236,557.44</b>	<b>2,755,024.77</b>

公司存货主要为原材料、半成品及库存商品，其中原材料主要为向供应商采购的加工完成的晶圆，在产品主要指委托加工中处于中测、封装、成测等不同阶段的半成品，库存商品为加工完成并检测合格后发回公司的待售成品芯片。

存货取得时按照实际发生成本入账，发出存货采用月末一次加权平均法。

公司 2012 年末及 2013 年末存货余额分别占总资产的 49.15%及 21.64%。公司 2013 年 12 月 31 日与 2012 年 12 月 31 日相比，原材料金额下降较多，主要原因是 2012 年年底无锡华润上华科技有限公司给予公司一定的价格优惠，从而促使公司与其签订大批量委外加工订单，因此公司原材料库存增加。2013 年年底无锡华润上华科技有限公司拟给予公司的价格优惠到 2014 年年初才确定，公司与其大批量订单签订时间较晚，因此公司 2013 年年底原材料较少。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司存货资产不存在减值迹象，故未对存货计提

资产减值准备。

### (七) 固定资产

#### 1、固定资产类别及估计的使用年限、预计净残值及年折旧率

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
专用设备	10	5%	9.50%
通用设备	3-5	5%	19.00%-31.67%
运输设备	5	5%	19.00%
模具	工作量法(注)		

注：模具采用的折旧方法系工作量法中的产量法。

#### 2、固定资产原值、累计折旧和净值

类别	2013年12月31日(元)	2012年12月31日(元)
<b>一、账面原值合计</b>	<b>1,803,804.60</b>	<b>1,495,733.91</b>
通用设备	339,881.41	302,665.41
专用设备	3,400.00	3,400.00
运输工具	357,242.00	357,242.00
模具	1,103,281.19	832,426.50
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>1,338,297.56</b>	<b>833,555.22</b>
通用设备	270,937.87	212,424.71
专用设备	726.84	403.80
运输工具	229,992.80	162,116.72
模具	836,640.05	458,609.99
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>465,507.04</b>	<b>662,178.69</b>
通用设备	68,943.54	90,240.70
专用设备	2,673.16	2,996.20
运输工具	127,249.20	195,125.28
模具	266,641.14	373,816.51
<b>四、减值准备合计</b>	-	-
通用设备	-	-
专用设备	-	-
运输工具	-	-
模具	-	-
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>465,507.04</b>	<b>662,178.69</b>
通用设备	68,943.54	90,240.70
专用设备	2,673.16	2,996.20
运输工具	127,249.20	195,125.28
模具	266,641.14	373,816.51

通用设备主要为办公用电子设备包括电脑打印机等；专用设备为生产用包装机；运输设备为汽车；模具为生产设计所用芯片模具。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司固定资产使用状态良好，不存在减值迹象，故公司未对固定资产计提资产减值准备。

2012 年固定资产变动表具体如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)账面原值小计	635,694.41	860,039.50	-	1,495,733.91
通用设备	275,052.41	27,613.00	-	302,665.41
专用设备	3,400.00	-	-	3,400.00
运输工具	357,242.00	-	-	357,242.00
模具	-	832,426.50	-	832,426.50
(2)累计折旧小计	216,711.69	616,843.53	-	833,555.22
通用设备	122,390.29	90,034.42	-	212,424.71
专用设备	80.76	323.04	-	403.8
运输工具	94,240.64	67,876.08	-	162,116.72
模具	-	458,609.99	-	458,609.99
(3)账面净值小计	418,982.72	-	-	662,178.69
通用设备	152,662.12	-	-	90,240.70
专用设备	3,319.24	-	-	2,996.20
运输工具	263,001.36	-	-	195,125.28
模具	-	-	-	373,816.51
(4)减值准备小计	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
模具	-	-	-	-
(5)账面价值合计	418,982.72	-	-	662,178.69
通用设备	152,662.12	-	-	90,240.70
专用设备	3,319.24	-	-	2,996.20
运输工具	263,001.36	-	-	195,125.28
模具	-	-	-	373,816.51

2013 年固定资产变动表具体如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)账面原值小计	1,495,733.91	308,070.69	-	1,803,804.60
通用设备	302,665.41	37,216.00	-	339,881.41
专用设备	3,400.00	-	-	3,400.00
运输工具	357,242.00	-	-	357,242.00
模具	832,426.5	270,854.69	-	1,103,281.19

(2)累计折旧小计	833,555.22	504,742.34	-	1,338,297.56
通用设备	212,424.71	58,513.16	-	270,937.87
专用设备	403.8	323.04	-	726.84
运输工具	162,116.72	67,876.08	-	229,992.80
模具	458609.99	378,030.06	-	836,640.05
(3)账面净值小计	662,178.69	-	-	465,507.04
通用设备	90,240.70	-	-	68,943.54
专用设备	2,996.20	-	-	2,673.16
运输工具	195,125.28	-	-	127,249.20
模具	373816.51	-	-	266,641.14
(4)减值准备小计	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
模具	-	-	-	-
(5)账面价值合计	662,178.69	-	-	465,507.04
通用设备	90,240.70	-	-	68,943.54
专用设备	2,996.20	-	-	2,673.16
运输工具	195,125.28	-	-	127,249.20
模具	373816.51	-	-	266,641.14

报告期内不存在固定资产处置情况。

## (八) 无形资产

### 1、无形资产类别及估计的使用年限

项 目	摊销年限(年)
软件	5

### 2、公司报告期无形资产分类账面原值及摊销情况如下：

项 目	2013年12月31日(元)	2012年12月31日(元)
<b>一、账面原值合计</b>	<b>49,560.68</b>	<b>49,560.68</b>
软件	49,560.68	49,560.68
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>21,683.32</b>	<b>11,771.20</b>
软件	21,683.32	11,771.20
<b>三、减值准备合计</b>	-	-
软件	-	-
<b>四、账面价值合计</b>	<b>27,877.36</b>	<b>37,789.48</b>
软件	27,877.36	37,789.48

公司无形资产主要为外购软件，包括办公用金蝶软件、设计用集成电路自动

化分析再设计系统等。

公司目前的研究与开发支出均计入当期损益，未有研发费用资本化确认为无形资产的情形。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司无形资产使用状态良好，不存在减值迹象，故公司未对无形资产计提资产减值准备。

2012 年无形资产变动表具体如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)账面原值小计	21,355.55	28205.13	-	49,560.68
软件	21,355.55	28205.13	-	49,560.68
(2)累计摊销小计	5,619.72	6,151.48	-	11,771.20
软件	5,619.72	6,151.48	-	11,771.20
(3)账面净值小计	15,735.83	-	-	37,789.48
软件	15,735.83	-	-	37,789.48
(4)减值准备小计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
(5)账面价值合计	15,735.83	-	-	37,789.48
软件	15,735.83	-	-	37,789.48

2013 年无形资产变动表具体如下：

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1)账面原值小计	49,560.68	-	-	49,560.68
软件	49,560.68	-	-	49,560.68
(2)累计摊销小计	11,771.20	9,912.12	-	21,683.32
软件	11,771.20	9,912.12	-	21,683.32
(3)账面净值小计	37,789.48	-	-	27,877.36
软件	37,789.48	-	-	27,877.36
(4)减值准备小计	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
(5)账面价值合计	37,789.48	-	-	27,877.36
软件	37,789.48	-	-	27,877.36

## （九）递延所得税资产

### 1、已确认递延所得税资产

项 目	2013 年 12 月 31 日（元）	2012 年 12 月 31 日（元）
资产减值准备	16,157.31	9,620.05
合 计	16,157.31	9,620.05

## 2、可抵扣差异明细

项 目	2013年12月31日(元)	2012年12月31日(元)
坏账准备	129,258.44	76,960.40
合 计	<b>129,258.44</b>	<b>76,960.40</b>

## (十) 主要资产减值准备

1、公司资产减值准备主要包括应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、存货减值准备等。计提政策具体详见本节之“二、公司报告期内采用的主要会计政策和会计估计”。公司已按会计政策足额计提各项资产减值准备。

## 2、报告期内资产减值准备情况

项 目	2013年12月31日(元)	2012年12月31日(元)
应收账款坏账准备	129,258.44	76,960.39
其他应收款坏账准备	23,178.00	519.75
合 计	<b>152,436.44</b>	<b>77,480.14</b>

报告期内其他资产不存在减值迹象，故公司未对其他资产计提资产减值准备。

## 六、公司报告期内重大债务情况

## (一) 短期借款

报告期内公司的短期借款情况如下：

贷款单位	起止日	金额(元)	贷款利率
中国农业银行股份有限公司 无锡科技支行	2013.04.25 -2014.04.24	500,000.00	同期同档次基准 利率上浮 10%

2013年4月25日公司与中国农业银行股份有限公司无锡科技支行签订借款合同，获得短期借款50万元，借款期限为1年，公司在2013年11月30日提前偿还该笔款项，截至2013年12月31日公司短期借款余额为0元。

## (二) 应付票据

1、公司的应付票据情况如下：

到期日	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	3,016,716.39	100.00	259,826.28	100.00
合计	<b>3,016,716.39</b>	<b>100.00</b>	<b>259,826.28</b>	<b>100.00</b>

报告期内应付票据余额主要为公司采购所开立或承兑的商业汇票。

## 2、报告期内主要应付票据情况

(1) 截至2013年12月31日，公司主要应付票据情况：

债权人名称	与公司关系	金额(元)	比例(%)	到期日
无锡华润上华科技有限公司	无关联关系	1,372,848.00	45.51	1年以内
天水华天科技股份有限公司	无关联关系	843,500.20	27.96	1年以内
无锡中微腾芯电子有限公司	无关联关系	464,470.47	15.40	1年以内
江门市华凯科技有限中公司	无关联关系	335,897.72	11.13	1年以内
合计		<b>3,016,716.39</b>	<b>100.00</b>	

(2) 截至2012年12月31日，公司主要应付票据情况：

债权人名称	与公司关系	金额(元)	比例(%)	到期日
无锡中微腾芯电子有限公司	无关联关系	259,826.28	100.00	1年以内
合计		<b>259,826.28</b>	<b>100.00</b>	

## (三) 应付账款

1、应付账款按余额及账龄分类列示

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	1,234,247.28	100.00	687,085.48	99.60
1-2年	-	-	2,763.00	0.40
合计	<b>1,234,247.28</b>	<b>100.00</b>	<b>689,848.48</b>	<b>100.00</b>

截至2012年12月31日及2013年12月31日，公司的应付账款余额分别为689,848.48元、1,234,247.28元，均为应付货款。

2、截至2013年12月31日，应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项；应付账款中无欠付关联方款项。

3、报告期内主要应付账款情况

(1) 截至2013年12月31日，公司主要应付款项情况：

债权人名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占比(%)
天水华天科技股份有限公司	无关联关系	1,131,240.46	1年以内	91.65
无锡中微腾芯电子有限公司	无关联关系	103,006.82	1年以内	8.35
<b>合计</b>		<b>1,234,247.28</b>		<b>100.00</b>

(2) 截至2012年12月31日,公司应付款项欠款金额前五名情况:

债权人名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占比(%)
天水华天科技股份有限公司	无关联关系	493,906.81	1年以内	71.60
无锡中微腾芯电子有限公司	无关联关系	121,242.32	1年以内	17.57
无锡华润上华科技有限公司	无关联关系	67,651.34	1年以内	9.81
无锡华润上华半导体有限公司	无关联关系	4,285.01	1年以内	0.62
温州天行计算机有限公司	无关联关系	2,763.00	1-2年	0.40
<b>合计</b>		<b>689,848.48</b>		<b>100.00</b>

截至2013年12月31日,公司应付款项欠款金额为1,234,247.28元,与2012年12月31日金额相比增长较大,主要是公司对天水华天科技股份有限公司的委托封装/测试款尚未结算所致。

#### (四) 预收账款

1、预收账款按账龄分类列示:

账龄	2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1年以内	597,500.00	100.00	297,366.50	100.00
<b>合计</b>	<b>597,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>297,366.50</b>	<b>100.00</b>

公司预收账款为预收客户的货款,账期均为1年以内。2013年预收账款增加,系2013年公司预收深圳爱芯威电子有限公司500,000.00元货款所致。

2、截至2013年12月31日,预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项;预收账款中无预收关联方款项。

3、报告期内主要预收账款情况

(1) 截至2013年12月31日主要预收账款情况:

债权人名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占比(%)
深圳爱芯威电子有限公司	非关联方	537,500.00	1年以内	89.96
无锡市艾特微电子有限公司	非关联方	60,000.00	1年以内	10.04
<b>合计</b>		<b>597,500.00</b>		<b>100.00</b>

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日主要预收账款情况:

债权人名称	与本公司关系	金额(元)	账龄	占比(%)
四川久安芯电子科技有限公司	非关联方	130,723.50	1 年以内	43.96
无锡市菲尔特电子有限公司	非关联方	116,643.00	1 年以内	39.23
无锡友芯集成电路设计有限公司	非关联方	50,000.00	1 年以内	16.81
<b>合计</b>		<b>297,366.50</b>		<b>100.00</b>

#### (五) 应交税费

项目	2013 年 12 月 31 日(元)	2012 年 12 月 31 日(元)
企业所得税	799.25	5,872.37
个人所得税	1,155.15	-
印花税	479.50	-
防洪保安基金	3,783.87	4,063.50
<b>合计</b>	<b>6,217.77</b>	<b>9,935.87</b>

#### (六) 其他应付款

1、其他应付款明细及按账龄分类列示如下:

项目	2013 年 12 月 31 日(元)	2012 年 12 月 31 日(元)
应付员工垫款	-	200,000.00
应付员工报销款	122,462.01	100,184.92
<b>合计</b>	<b>122,462.01</b>	<b>300,184.92</b>

公司其他应付款均为应付员工垫款和应付员工报销款项。员工垫款为公司向员工所借款项。

账龄	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
1 年以内	122,462.01	100.00	300,184.92	100.00
<b>合计</b>	<b>122,462.01</b>	<b>100.00</b>	<b>300,184.92</b>	<b>100.00</b>

公司其他应付款账龄均在 1 年以内。

2、其他应付款主要债权人明细情况

(1) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司主要其他应付款项情况:

债权人名称	与本公司关系	金额(元)	占比(%)	账龄	性质
郑云华	公司股东	76,260.01	62.27	1 年以内	报销款
韩基东	公司股东	34,838.00	28.45	1 年以内	报销款
戴琴莎	员工	7,912.00	6.46	1 年以内	报销款

白宇	员工	3,452.00	2.82	1年以内	报销款
<b>合计</b>		<b>122,462.01</b>	<b>100.00</b>		

截至 2013 年 12 月 31 日，公司其他应付款项欠款金额主要债权人合计 122,462.01 元，占其他应付款项总额比例 100%，欠款年限为 1 年以内。

(2) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司主要其他应付款项情况：

债权人名称	与本公司关系	金额（元）	占比（%）	账龄	性质
郑云华	公司股东	247,276.66	82.38	1年以内	垫款 200,000.00 报销款 47,276.66
戴琴莎	员工	24,677.10	8.22	1年以内	报销款
韩基东	公司股东	17,932.76	5.97	1年以内	报销款
白宇	员工	10,298.40	3.43	1年以内	报销款
<b>合计</b>		<b>300,184.92</b>	<b>100.00</b>		

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应付款项欠款金额主要债权人合计 300,184.92 元，占其他应付款项总额比例 100%，欠款年限为 1 年以内。其中股东郑云华垫款 200,000.00 元系公司向股东的无息借款，公司于 2012 年 12 月 17 日和 2012 年 12 月 31 日分别向股东郑云华借款 50,000.00 元和 150,000.00 元。

### 3、其他应付持有公司关联方款项情况

截至 2013 年 12 月 31 日，其他应付公司关联方款项情况：

股东名称	欠款金额（元）
郑云华	76,260.01
韩基东	34,838.00
<b>合计</b>	<b>111,098.01</b>

截至 2012 年 12 月 31 日，其他应付持有公司关联方款项情况：

股东名称	欠款金额（元）
郑云华	247,276.66
韩基东	17,932.76
<b>合计</b>	<b>265,209.42</b>

### (七) 应付职工薪酬

项目	2013 年 12 月 31 日（元）	2012 年 12 月 31 日（元）
工资、奖金、津贴和补贴	51,044.85	43,546.48
职工福利费	-	-
社会保险费	21,496.00	17,742.00

其中：医疗保险费	4,617.00	3,168.00
基本养老保险费	14,364.00	9,856.00
失业保险费	1,027.00	704.00
工伤保险费	410.00	282.00
生育保险费	462.00	318.00
补充医疗保险	616.00	422.00
住房公积金	-	2,992.00
职工教育经费	-	-
<b>合 计</b>	<b>72,540.85</b>	<b>61,288.48</b>

应付职工薪酬期末数主要为各期末已计提未支付的员工工资、社保等。

## 七、公司报告期股东权益情况

项目	2013年12月31日(元)	2012年12月31日(元)
实收资本(或股本)	5,000,000.00	4,000,000.00
资本公积	50,557.44	-
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	23,266.57	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	209,399.16	-25,377.60
外币报表折算差额	-	-
<b>股东权益总计</b>	<b>5,283,223.17</b>	<b>3,974,622.40</b>

2012年7月23日，经公司股东会批准，公司申请增加注册资本100万元，由郑云华、韩基东各出资5万元、王成琴出资10万元、朱星海出资80万元，均以货币资金出资。

2013年10月18日，经公司股东会批准，公司申请增加注册资本100万元，由各股东按其持有本公司股权比例以货币资金增资。

2013年12月9日，经股东会决议，公司的全体出资人以其拥有的公司截至2013年10月31日经审计的净资产5,050,557.44元中的5,000,000.00元按原出资比例1:1折合认购本公司股份5,000,000股，其余净资产50,557.44元作为资本公积(股本溢价)。整体变更后，公司注册资本500万元，股份总数为500万股(每股面值1元)，其中郑云华出资175万元，占注册资本的35%；韩基东出资175万元，占注册资本的35%；王成琴出资50万元，占注册资本的10%；朱星海出资100万元，占注册资本的20%。

## 八、关联方及关联方交易

### (一) 关联方

#### 1、存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	持股比例(%)
郑云华	控股股东、董事长、总经理	35.00
韩基东	控股股东、董事、副总经理、董事会秘书	35.00
合计		70.00

郑云华与韩基东分别持有公司 175.00 万股，合计占公司 70%的股权，拥有本公司的实际控制权，故郑云华、韩基东为本公司控股股东、实际控制人。

#### 2、不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系	持股比例(%)
朱星海	股东、董事	20.00
王成琴	股东、监事会主席	10.00
白 宇	董事	-
叶 叶	董事	-
朱 舰	监事	-
吴彩虹	职工监事	-
戴琴莎	财务总监	-
宁波市鑫甬鑫液压机械有限公司	朱星海参股企业	-
合计		30.00

宁波市鑫甬鑫液压机械有限公司由朱朝霞与朱星海共同发起设立，其中朱朝霞持股 60%，为控股股东，朱星海持股 40%；注册号为 330206000035209，注册资本为 150 万元人民币；法定代表人为朱朝霞；住所为北仑区小港镇孔墅村胡家塔 300 号；经营范围为机电设备及配件，五金制品，金属制品，模具的制造、加工、批发、零售；阀门，电动机，电子元件的批发、零售；机械配件，电子元件及配件的维修、保养；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。

#### 3、受实际控制人控制的其他企业

不存在受实际控制人控制的其他企业。

### (二) 关联交易情况

## 1、销售商品、提供劳务的关联交易

不存在销售商品、提供劳务的关联交易。

## 2、其他关联交易

关联方资金往来：

项 目	关联方	2013 年 12 月 31 日 (元)	2012 年 12 月 31 日 (元)
其他应付款	郑云华	76,260.01	247,276.66
其他应付款	韩基东	34,838.00	17,932.76
合 计		<b>111,098.01</b>	<b>265,209.42</b>

2012 年关联方资金往来具体情况：

项 目	2012 年期初数	本期增加	本期减少	2012 年期末数
其他应付款				
郑云华	237,544.21	1,898,276.65	1,888,544.20	247,276.66
韩基东	0.00	97,932.76	80,000.00	17,932.76
合计	237,544.21	1,996,209.41	1,968,544.20	265,209.42

2013 年关联方资金往来具体情况：

项 目	2013 年期初数	本期增加	本期减少	2013 年期末数
其他应付款				
郑云华	247,276.66	507,906.30	678,922.95	76,260.01
韩基东	17,932.76	308,356.20	291,450.96	34,838.00
合计	265,209.42	816,262.50	970,373.91	111,098.01

公司 2012 年、2013 年其他应付款中：①应付股东郑云华的贷方增加额大多为郑云华为公司垫付的采购货款，部分为应付郑云华的费用报销款项，因此发生额金额较大。②应付股东韩基东的贷方增加额均为应付韩基东的费用报销款项。

上述其他应付款均为员工为公司垫付款项以及公司尚未支付的报销款。截至 2013 年 12 月 31 日，公司无其他关联方的往来款。无关联方购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

### (三) 关联交易决策程序

有限公司时期，公司未建立相关关联交易决策制度，关联交易决策程序不规范。

股份公司成立后，在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

及《关联交易决策制度》中都明确了关联交易的审批及决策程序。在未来运营过程中，公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》及《关联交易决策制度》的相关规定，对关联交易进行规范。

## **九、需要提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项**

### **（一）期后事项**

截至本说明书披露日，公司无需要披露的期后事项。

### **（二）或有事项**

截至本说明书披露日，公司无需要披露的或有事项。

### **（三）其他重要事项**

截至本说明书披露日，公司无需要披露的其他重要事项。

## **十、公司报告期内资产评估情况**

公司报告期内进行过一次资产评估。2013年11月22日，开元资产评估有限公司出具了开元评报字[2013]第163号《无锡汉咏微电子有限公司拟整体变更之公司净资产价值评估报告》。评估的具体情况如下：

资产评估目的：为无锡汉咏微电子有限公司拟整体变更为股份公司提供公司净资产于评估基准日的市场价值参考依据。

评估对象及范围：评估对象为无锡汉咏微电子有限公司于评估基准日的净资产价值。评估范围包括无锡汉咏微电子有限公司于评估基准日拥有的符合《公司法》规定的全部出资资产和承担的全部负债。资产类型具体包括流动资产、非流动资产，负债类型主要是流动负债，其中：非流动资产具体包括固定资产、无形资产和递延所得税资产。

评估基准日：2013年10月31日

主要评估方法：资产基础法（成本法）

评估结果：截至评估基准日 2013 年 10 月 31 日，无锡汉咏微电子股份有限公司经审计确认的资产总额账面价值 994.58 万元，负债总额账面价值 489.53 万元，净资产账面价值 505.05 万元。在持续经营前提下，经资产基础法评估，符合《公司法》规定的全部出资资产评估价值 1,042.94 万元，总负债的评估值为 489.53 万元，符合《公司法》规定的出资条件的净资产评估值 553.41 万元（人民币伍佰伍拾叁万肆仟壹佰元整），评估增值额为 48.36 万元，增值率为 9.58%。

公司股份改制时按相关要求进行了资产评估，评估方法符合资产项目实际情况。资产评估前的账面价值与评估值相比变化不大。

## 十一、股利分配政策和报告期内的分配情况

### （一）股利分配的一般政策

根据国家有关法律、法规的要求及公司《公司章程》的规定，各年度的税后利润按照下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取 10%法定盈余公积金；
- 3、提取任意盈余公积金，具体比例由股东大会决定；
- 4、分配普通股股利。由董事会提出预分方案，经股东大会决定，分配股利。

### （二）股利分配的具体政策

- 1、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
- 2、法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
- 3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
- 4、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

### （三）报告期内的股利分配情况

报告期内，公司未发生股利分配的情况。

#### （四）公开转让后的股利分配政策

除股利的一般政策外，公司目前尚无公开转让后的具体股利分配政策。

## 十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的风险因素及自我评估

### （一）公司治理风险

股份公司成立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制制度，但由于股份公司成立时间较短，各项规章制度的执行尚需检验，公司治理和内部控制制度仍需逐步完善。随着公司的较快发展，经营规模和业务范围不断扩大，人员增多，对公司治理提出更高要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应公司快速发展，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

针对以上风险，公司将对管理层在公司治理和规范运作方面进行培训，督促股东、董事、监事和高级管理人员严格按照相关制度履行职责，进一步完善内部控制体系。

### （二）技术人才短缺风险

公司作为集成电路设计企业，核心竞争力在于自主研发能力和稳定的研发团队。公司的发展很大程度上取决于产品的研发速度，因此公司对高端技术人才有较大需求。国内集成电路企业对于高端集成电路设计人才的争夺日趋激烈，公司能否保留并吸引更多人才，对于公司未来的发展至关重要，所以公司面临技术人员短缺的风险。

针对以上风险，公司通过塑造良好的工作环境、给予员工有效的激励体系和完善的培训机制来增强相关人员的企业归属感和凝聚力；通过签订保密协议，采取及时申请专利权等手段以保护公司的知识产权、核心技术；同时公司也在积极进行人才储备，增强公司研发实力和抗风险能力。

### （三）营业区域集中的风险

报告期内，公司营业收入的区域集中度较高，主营业务收入中来自于华南和华东地区的营业收入合计占主营业务收入总额的比例在2012年度和2013年度分别为92.32%和94.31%，销售区域集中在一定程度上影响了公司市场占有率和营业收入的进一步提升。因此公司仍存在核心市场区域集中的风险，一旦该区域市场竞争加剧或投资量大幅下滑，将对公司经营业绩产生重大影响。

针对以上风险，公司将加大市场开拓力度，积极发展新客户。同时，加强新产品的研发、延伸现有产品链，拓展新的业务领域，实现收入来源多元化，降低对单一客户的依赖。

#### **（四）委托加工风险**

公司作为集成电路设计企业，采取“自主研发+委外加工”的经营模式。公司仅从事集成电路芯片的设计、销售业务，芯片制造、封装、测试等环节需要依赖外部的供应商完成。2012年度公司对前五大供应商合计采购金额为9,001,438.59元，占当年采购总额的90.08%；2013年度公司对前五大供应商合计采购金额为9,757,154.45元，占当年采购总额的91.31%。2012年与2013年主要供应商采购比例均较大，存在一定程度的委外加工风险。

今后公司产品在不同的代工环节将选择多家供应商合作，与其签订长期的合作协议，避免某家供应商的工艺平台不能正常生产时对公司销售造成不利影响。

#### **（五）对非经常性损益依赖风险**

公司2012年度、2013年度公司非经常性损益分别为57,618.75元、807,471.91元，主要是2012年度及2013年度获得无锡市人民政府新区管理委员会政府补贴65,850.00元、807,875.00元，政府补贴构成主要为房租补贴、科技企业补贴，2012及2013年度非经常性损益占净利润比例分别为51.24%、261.66%。如果公司业务不能实现更快的增长，在公司无法持续获得政府补贴时，将会对公司今后盈利水平的快速提升产生不利影响。

针对以上风险，公司将加大市场开拓力度，提高公司经营、收入规模；同时，将加大科研开发力度，积极研发高附加值的产品，保持公司主营业务的持续增长，降低对非经常性损益的依赖程度。

### 第五节 有关声明

#### 一、《无锡汉咏微电子股份有限公司公开转让说明书》之签字、盖章页

董事：

郑云华： 郑云华

韩基东： 韩基东

朱星海： 朱星海

白宇： 白宇

叶叶： 叶叶

监事：

王成琴： 王成琴

吴彩虹： 吴彩虹

朱舰： 朱舰

高级管理人员：

郑云华： 郑云华

韩基东： 韩基东

戴琴莎： 戴琴莎

无锡汉咏微电子股份有限公司

2014 年 7 月 14 日



## 二、主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

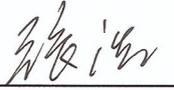
法定代表人：

姚志勇：



项目负责人：

张浩：

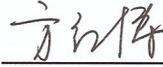


项目小组成员：

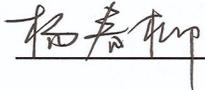
陆茜：



方红涛：



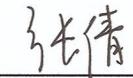
杨春柳：



惠宇：



张倩：



国联证券股份有限公司



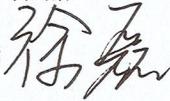
2014年7月14日

## 律师事务所声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

机构负责人：徐磊

徐磊（签字）：

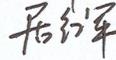


经办律师：薛孝东、居红军

薛孝东（签字）：



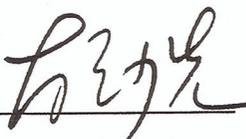
居红军（签字）：



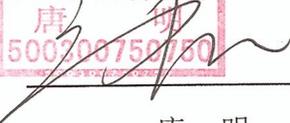
2014 年 7 月 14 日

#### 四、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读无锡汉咏微电子股份有限公司公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对无锡汉咏微电子股份有限公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：    
胡少先

签字注册会计师：    
龙文虎

   
唐明

  
天健会计师事务所（特殊普通合伙）

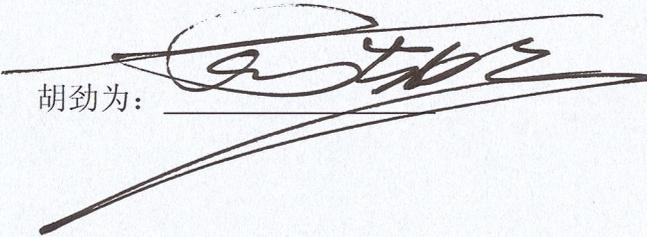
2014 年 7 月 14 日

## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

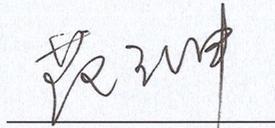
资产评估机构负责人：

胡劲为：

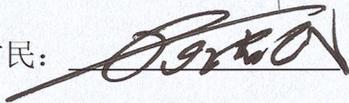


签字注册资产评估师：

范玉坤：



张佑民：



## 第六节 附件

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的审查意见

(正文完)